
上海晟矽微电子股份有限公司 公开转让说明书



推荐主办券商



二零一三年六月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

1. 同业竞争风险

报告期内，公司控股股东、实际控制人陆健控制的上海谋胜微电子有限公司与公司存在同业竞争风险。谋胜微电子在行业内积累了一些长期合作的客户，2011年下半年起仅作为公司针对部分客户的销售渠道，不再进行MCU设计制造。谋胜微电子已将其名下的6项集成电路布图设计专有权参考历史成本作价转让给公司。为解决与公司的同业竞争问题，谋胜微电子已于2013年4月召开股东会决议关闭，同时成立清算委员会展开清算工作，并已于2013年5月9日刊登了注销公告。45天公告期截至2013年6月23日止，之后谋胜微电子将清偿其全部债务并结算缴纳税款及其他款项。预计谋胜微电子将于2013年7月完成注销手续。截至本说明书签署日，谋胜微电子尚未完成注销，同业竞争问题的解决仍存在不确定性。

2. 关联方交易风险

公司在2011年、2012年期间向关联方上海谋胜微电子有限公司销售商品12,203,527.09元、14,115,595.65元，分别占同期营业收入的49.07%、30.59%；向关联方上海中基国威电子有限公司销售商品2,393,732.22元、7,138,529.59元，分别占同期营业收入的9.63%、15.47%。2011年、2012年公司关联方销售额的合计数分别占同期营业收入的58.70%、46.06%，关联方销售额占比较高。

同时公司在2011年、2012年期间向上海谋胜微电子有限公司采购商品1,732,241.07元、10,009,885.71元，分别占同期采购金额的6.17%、18.91%。向上海中基国威电子有限公司采购商品254,650.00元、175,429.45元，分别占同期采购金额的0.91%、0.33%。2011年、2012年公司关联方采购额的合计数分别占同期采购额的7.08%、19.24%。关联方交易金额重大，公司长期过度依赖关联方会影响公司业务的独立性、市场竞争力以及未来业务的发展壮大。

3. 产品研发，技术升级方面的风险

集成电路设计行业的主要特点之一是研发周期长、投入大，通常从了解市场需求，到进行可行性研究、产品研发、样品测试、试验生产、投入量产等分为多个阶段，投入生产后还要面临市场接受度不高的风险。同时，近年来集成电路行业的下游新兴产业需求推动了32位MCU市场的增长，32位MCU的发展可能对8位/16位MCU市场有一定的替代性。尽管由于8位MCU成本低，易于开发，目前仍占据着MCU市场最大的份额，短期内32位难以替代它成为市场主流，但长期内公司仍然面临着行业技术不断升级，需要不断加大研发投入及研发的新产品能否为市场所接受的风险。

目 录

释 义.....	1
第一章 公司基本情况	3
一、公司情况	3
二、股票挂牌情况	4
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	4
四、公司股权结构	5
五、公司设立以来股本的形成及其变化情况	8
六、公司重大资产重组情况	11
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	11
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标	13
九、与本次挂牌有关机构	14
第二章 公司业务	16
一、业务情况	16
二、公司主要业务流程和方式	21
三、与公司业务相关的关键资源要素	23
四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况.....	31
五、公司的商业模式	37
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征	37
七、公司面临的主要竞争状况	43
第三章 公司治理.....	46
一、公司三会建立健全及运行情况	46
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估	47
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	49
四、公司的独立性	50
五、同业竞争情况	52
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	54
七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况	55
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.....	57
第四章 公司财务.....	59
一、最近两年的审计意见及主要财务报表	59
二、公司的主要会计政策及会计估计	67
三、报告期利润形成的有关情况	79
四、公司最近两年主要资产情况	83
五、公司最近两年的重大债务情况	91
六、报告期股东权益情况	95
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	96
八、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	103
九、股利分配政策和最近两年分配情况	104

十、历次资产评估情况	104
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	105
十二、风险因素及评估	105
第五章 定向发行.....	109
一、拟发行股数	109
二、拟发行对象范围	109
三、拟发行价格区间	109
四、预计募集资金金额	109
第六章 有关声明.....	110
一、公司声明	110
二、主办券商声明	111
三、律师事务所声明	112
四、会计师事务所声明	113
五、资产评估机构声明	114
第七章 附件	115

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、晟矽微电子	指	上海晟矽微电子股份有限公司及其前身上海晟矽微电子有限公司
谋胜微电子	指	上海谋胜微电子有限公司
谋胜投资、谋胜投资公司	指	上海谋胜投资管理有限公司
上海华虹	指	上海华虹攀芯电子科技有限公司
中基国威	指	上海中基国威电子有限公司
上海中基	指	上海中基微电子有限公司
上海拓芯	指	上海拓芯电子有限公司
华天科技	指	华天科技（西安）有限公司
天水华天	指	天水华天科技股份有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	上海晟矽微电子股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	上海晟矽微电子有限公司章程
报告期、最近两年	指	2011 年度及 2012 年度
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
内核小组	指	广发证券股份有限公司内核小组
说明书、本说明书	指	上海晟矽微电子股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书
集成电路 (Integrated Circuit, 简称“IC”)	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
晶圆	指	晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。
布图	指	确定用以制造集成电路的电子元件在一个传导材料中的几何图形排列和连接的布局设计。
振荡器	指	用来产生重复电子讯号（通常是正弦波或方波）的电子元件，其构成的电路叫振荡电路，能将直流电转换为具有一定频率交

		流电信号输出的电子电路或装置。
封装	指	指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
嵌入式处理器	指	嵌入式系统的核心，是控制、辅助系统运行的硬件单元。范围极其广阔，从最初的4位处理器，目前仍在大规模应用的8位单片机，到最新的受到广泛青睐的32位、64位嵌入式CPU。
微控制单元（Micro Control Unit，简称“MCU”）	指	又称单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）或者单片机，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。
ASIC	指	专用集成电路（Application Specific Intergrated Circuits），应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求，品种多、批量少，要求设计和生产周期短，是集成电路技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物。
IP核（Intellectual Property core）	指	是一段具有特定电路功能的硬件描述语言程序，该程序与集成电路工艺无关，可以移植到不同的半导体工艺中去生产集成电路芯片。通常已验证、可重复利用、具有某种确定功能。
Fabless	指	无生产线的IC设计公司。
CISC	指	复杂指令集（Complex Instruction Set Computing），它的设计目的是要用最少的机器语言指令来完成所需的计算任务，因而指令系统庞大，指令功能复杂，指令格式、寻址方式多；绝大多数指令需多个机器周期完成；各种指令都可访问存储器；难以用优化编译技术生成高效的目标代码程序
RISC	指	精简指令集（Reduced Instruction Set Computing），它的指令系统相对简单，它只要求硬件执行很有限且最常用的那部分指令，大部分复杂的操作则使用成熟的编译技术，由简单指令合成。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一章 公司基本情况

一、公司情况

中文名称：上海晟矽微电子股份有限公司

英文名称：Shanghai SinoMCU Microelectronics CO., LTD

注册资本：定向发行前为 725 万元，定向发行后为 929.4872 万元^注

法定代表人：陆健

有限公司成立日期：2010 年 11 月 26 日

股份公司设立日期：2013 年 2 月 18 日

住所：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 563 号 2 幢 601、602、603 室

电话：021-38682906 传真：021-38682905

互联网网址：<http://www.sinomcu.com/>

信息披露负责人：胡璨

电子邮箱：hr@sinomcu.com

所属行业：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）；C3963 集成电路制造业（根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）

经营范围：电子产品和集成电路领域内的技术设计、技术开发、技术测试，从事货物及技术的进口业务，计算机网络工程（除专项审批），销售集成电路、电子产品、计算机软硬件、电脑耗材、通讯设备。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

主营业务：高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型 8 位微控制器产品的设计及销售

组织机构代码：56484630-0

注:有关本次挂牌同时定向发行情况详见“第五章 定向发行”

二、股票挂牌情况

股票代码：430276

股票简称：晟矽微电

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：定向发行前为 7,250,000 股，定向发行后为 9,294,872 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股本总额为 7,250,000 股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。

截至本说明书签署日，股东所持股份解限售情况如下：

序号	股东名称	任职情况	是否为控股股东、实际控制人持股	持股数（万股）	持股比例（%）	股份是否冻结/质押	挂牌时可转股数（万）
----	------	------	-----------------	---------	---------	-----------	------------

							股)
1	陆健 (发起人)	董事长、总经理	是 (直接持股)	250.00	34.48	否	0.00
2	上海谋胜投资管理有限公司	—	是 (间接持股)	225.00	31.04	否	75.00
3	张文荣 (发起人)	副董事长、副总经理	否	150.00	20.69	否	0.00
4	刘蕾 (发起人)	—	否	100.00	13.79	否	0.00
合计				725.00	100.00		75.00

截至本说明书签署日, 股份公司成立未满一年, 发起人股东陆健、张文荣、刘蕾持有的 500 万股公司股份不得转让。上海谋胜投资管理有限公司在股份公司成立后增资所持的 225 万股公司股份不受上述限制; 控股股东、实际控制人陆健持有上海谋胜投资管理有限公司 30.84% 的股权, 并任该公司的执行董事、经理兼法定代表人, 可以在实质上控制该公司。因此上海谋胜投资管理有限公司持有的公司股份依照控股股东、实际控制人间接持股的相关规则分三批解除转让限制, 挂牌时可转让 75 万股。公司全体股东的股份均无冻结、质押或其他转让限制情况。

此外, 上海谋胜投资管理有限公司《章程》规定: 晟矽微电子在全国中小企业股份转让系统挂牌前, 谋胜投资公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权, 转让价格由双方协商确定, 但除陆健之外的其他股东不得向股东之外的第三人转让; 如其他股东均不愿受让, 该股东可以将其股权转让给陆健, 转让价格按照该等股权所对应的晟矽微电子的净资产值确定, 即: 转让价格=拟转让的股权比例* (晟矽微电子的净资产值*谋胜投资公司所持晟矽微电子的股权比例)。晟矽微电子在全国中小企业股份转让系统挂牌后, 谋胜投资公司的股东可以自行向其他股东或股东之外的第三人转让其全部或部分股权, 转让价格亦由转让双方协商确定。除上述《章程》约定外, 谋胜投资公司的股东所持股份不存在其他限制和特别约定。

四、公司股权结构

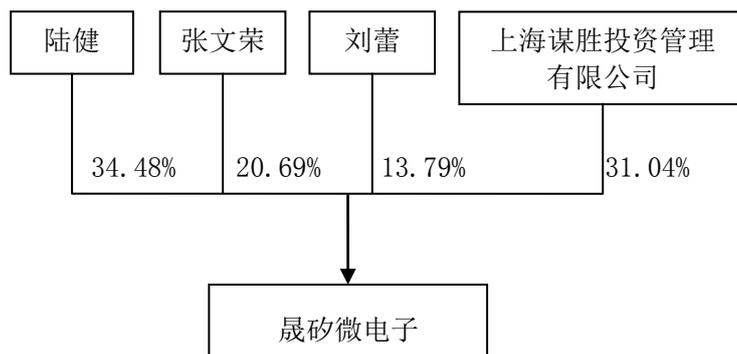
(一) 公司股权结构

截至本说明书签署日, 公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认购股份数 (万股)	出资方式	占总股本比例 (%)
----	------	------------	------	------------

1	陆健	250.00	净资产	34.48
2	上海谋胜投资管理 有限公司	225.00	货币	31.04
3	张文荣	150.00	净资产	20.69
4	刘蕾	100.00	净资产	13.79
合计		725.00	—	100.00

公司的股权结构图如下：



（二）控股股东和实际控制人基本情况

自2010年公司设立至2013年3月，陆健先生一直持有公司50%的股权。2013年4月，上海谋胜投资管理有限公司向公司增资后，陆健先生直接持有公司股份250万股，占公司总股本比例的34.48%，是公司的相对控股股东；同时，陆健先生还持有谋胜投资公司30.84%的股权，是该公司的第一大股东，并担任其法定代表人、执行董事兼经理。截至本说明书签署日，陆健先生直接持有公司34.48%的股份，并通过谋胜投资公司间接持有公司9.57%的股份。自公司设立以来，陆健先生一直是公司的第一大股东，且一直担任公司执行董事或董事长、总经理，全面负责公司经营管理。因此，陆健先生是公司的控股股东和实际控制人。

陆健先生，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，1999年至2002年就读于复旦大学微电子专业，获硕士学位。陆健先生1999年7月至2006年9月在上海贝岭股份有限公司工作，历任设计副经理、产品开发经理、产品线经理。2006年9月至2009年12月任上海贝岭矽创微电子有限公司副总经理。2010年起经

营管理上海谋胜微电子有限公司。2010年11月创立上海晟矽微电子有限公司，任执行董事兼总经理。2013年1月27日经公司创立大会选举为董事，同日经第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期均为三年。

最近两年内公司的控股股东和实际控制人为陆健先生，未发生变化。公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

(三) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称	认购股份数(万股)	出资方式	占总股本比例(%)
1	陆健	250.00	净资产	34.48
2	上海谋胜投资管理有限公司	225.00	货币	31.04
3	张文荣	150.00	净资产	20.69
4	刘蕾	100.00	净资产	13.79
合计		725.00	—	100.00

(四) 公司股东相互间的关联关系

上海谋胜投资管理有限公司设立于2012年12月21日，注册资本225万元，注册号为310115002058464，注册地址为上海市张江高科技园区松涛路563号1幢305室，经营范围为“投资管理，实业投资，投资咨询（除经纪）。”谋胜投资公司是晟矽微电子的法人股东，持有其225万股股份。除此之外，谋胜投资公司未投资控制其它公司。谋胜投资公司的股东均为晟矽微电子的员工，持股情况如下：

序号	股东名称	在晟矽微电子任职	出资额(万元)	占比(%)
1	陆健	总经理	69.4000	30.8444
2	罗鹏	模拟IP设计组经理	33.6000	14.9333
3	郑朝晖	运营主管	30.0000	13.3333
4	潘云燕	设计工程师	20.0000	8.8890
5	孙建刚	版图组设计经理	12.0000	5.3333
6	李秀峰	数字设计组工程师	12.0000	5.3333
7	胡璨	财务总监	12.0000	5.3333
8	莫光锋	应用开发部副经理	9.0000	4.0000

9	梁会锋	营运总监	9.0000	4.0000
10	梁东	副总经理	6.0000	2.6667
11	郑义	华东销售总监	6.0000	2.6667
12	秦伟华	顺德办经理	6.0000	2.6667
合计			225.0000	100.0000

截至本说明书签署日，公司股东陆健持有谋胜投资公司 30.84%的股权，担任该公司的法定代表人、执行董事兼经理，可以在实质上控制该公司。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

五、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）有限公司成立

上海晟矽微电子股份有限公司前身为上海晟矽微电子有限公司。2010年11月26日，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，有限公司成立，注册号为310115001766129。有限公司注册资本200万元，由陆健、张文荣和刘蕾出资组建。

有限公司的经营范围是：“集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。]”

2010年10月21日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（申洲大通(2010)验字第381号），对公司截至2010年10月15日设立登记的注册资本实收情况进行了审验，验证全体股东首次出资60万元已缴纳完毕。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	首期出资额 (万元)	出资方式	占注册资本 比例 (%)
1	陆健	100.00	50.00	30.00	货币	15.00
2	张文荣	60.00	30.00	18.00	货币	9.00
3	刘蕾	40.00	20.00	12.00	货币	6.00
	合计	200.00	100.00	60.00	货币	30.00

（二）有限公司注册资本缴足

2011年4月，有限公司全体股东缴纳第二期出资140万元。

2011年4月20日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（申洲大通(2011)验字第133号），对公司截至2011年4月14日的注册资本实收情况进行了审验，验证陆健、张文荣、刘蕾分别以货币缴纳70万元、42万元、28万元，有限公司全体股东认缴出资已缴足。

本期出资缴纳后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	陆健	100.00	100.00	货币	50.00
2	张文荣	60.00	60.00	货币	30.00
3	刘蕾	40.00	40.00	货币	20.00
合计		200.00	200.00	货币	100.00

有限公司办理了工商变更登记，并于2011年4月25日取得了变更后的营业执照。

（三）有限公司整体变更为股份公司、更改住址和经营范围

根据有限公司于2013年1月12日召开的股东会的相关决议，有限公司拟由公司现有全体股东作为发起人，以经审计的截止2012年12月31日的公司净资产值为折股依据，整体变更设立“上海晟矽微电子股份有限公司。”同日，发起人各方正式签署了设立股份公司的《发起人协议》。

根据北京中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年1月10日出具的《审计报告》（中瑞岳华审字[2013]第0029号），截至2012年12月31日，有限公司经审计的净资产额为5,238,711.68元。

根据北京金正元资产评估有限责任公司2013年1月11日出具的金评报字[2013]第001号《资产评估报告书》，截至2012年12月31日，公司评估后的净资产为623.13万元。

2013年1月12日，北京中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）针对整体变更出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0026号），验证截至2013年1月12日，股份公司（筹）已收到全体股东缴纳的股本合计人民币5,000,000.00

元。各发起人以其持有的公司所对应的权益出资，以公司截至 2012 年 12 月 31 日止经审计账面净资产折合成公司股本 5,000,000.00 元，余额 238,711.68 元转入股份公司（筹）资本公积。

2013 年 1 月 27 日，股份公司全体发起人召开创立大会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，以公司经审计的净资产 5,238,711.68 元按 1:0.9544 的比例折合为股本 5,000,000 股，每股人民币 1 元，余额 238,711.68 元计入股份公司资本公积，有限公司整体变更为股份公司，并选举了股份公司第一届董事会和股东代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举了股份公司职工代表监事。

2013 年 2 月 18 日，上海市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》。整体变更后，公司的住所更改为“上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 563 号 2 幢 601、602、603 室”，经营范围更改为“集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。]”

至此，股份有限公司股权结构如下：

序号	发起人名称	认购股份数(万股)	出资方式	占总股本比例(%)
1	陆健	250.00	净资产	50.00
2	张文荣	150.00	净资产	30.00
3	刘蕾	100.00	净资产	20.00
合计		500.00	净资产	100.00

（四）股份公司第一次增资

2013 年 1 月 27 日，股份公司全体发起人召开创立大会，决议公司向上海谋胜投资管理有限公司增发股份。

2013 年 4 月 12 日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（申洲大通(2013)验字第 081 号），对公司截至 2013 年 4 月 10 日的注册资本实收情况进行了审验，验证谋胜投资公司以货币缴纳新增注册资本 225 万元。本次增资参照 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产额 5,238,711.68 元计算，每股净资产 1.05 元/股，增资价格为 1 元/股。公司变更后的注册资本为 725 万元。

增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认购股份数(万股)	出资方式	出资比例(%)
1	陆健	250.00	净资产	34.48
2	上海谋胜投资管理 有限公司	225.00	货币	31.04
3	张文荣	150.00	净资产	20.69
4	刘蕾	100.00	净资产	13.79
合计		725.00	—	100.00

股份公司办理了工商变更登记，并于2013年4月23日取得了变更后的营业执照。

至此，公司目前的股权结构正式形成。

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

1、陆健先生，公司董事长，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“(二) 控股股东和实际控制人基本情况”。2013年1月27日经公司创立大会选举为董事，同月经第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期均为三年。

2、张文荣先生，1977年出生，中国籍，毕业于上海交通大学，硕士学历。自2002年起从事集成电路设计业，曾任上海贝岭股份有限公司研发中心集成电路设计工程师，2006年9月至2009年12月任上海贝岭矽创微电子有限公司设计部经理，2010年任上海谋胜微电子有限公司技术总监。2010年11月作为股东之一创办上海晟矽微电子有限公司，任技术总监。2013年1月27日经公司创立大会选举为董事，同月经第一届董事会第一次会议选举为副董事长并聘任为副总经理，任期均为三年。张文荣先生持有公司股份150万股。

3、于涛先生，1979年出生，中国籍，毕业于江西师范大学，本科学历。自2001年起从事集成电路行业，历任上海红邦电子有限公司职员、上海天那电器

有限公司产品经理，目前为自由职业。于涛是公司股东刘蕾的表弟，2013年1月27日经公司创立大会选举为董事，任期为三年。

4、罗鹏先生，1978年出生，中国籍，毕业于上海复旦大学，硕士学历。自1999年起从事集成电路设计业，历任无锡华晶公司技术中心设计工程师、上海贝岭股份有限公司技术中心设计工程师、上海贝岭矽创微电子有限公司研发部设计工程师。2011年加入公司，现任公司技术部模拟IP设计组经理。2013年1月27日经公司创立大会选举为董事，任期为三年。

5、胡璨女士，1984年出生，中国籍，获东华大学工商管理专业学士学位，自2006年起进入集成电路设计业，历任上海贝岭矽创微电子有限公司运营主管、上海谋胜微电子有限公司人事行政总监兼任运营主管。2010年加入公司，现任公司行政总监、财务总监。2013年1月27日经公司创立大会选举为董事，同日经第一届董事会第一次会议聘任为财务总监，任期均为三年。

（二）公司监事

1、李秀峰先生，1981年出生，中国籍，获青岛大学应用物理学学士学位、华中科技大学微电子与固体电子学硕士学位。2006年至2009年于上海贝岭矽创微电子有限公司任数字设计工程师。2010年于上海贝岭股份有限公司任数字设计工程师。2010年7月在上海谋胜微电子有限公司任资深数字设计工程师。2011年加入本公司，现任公司技术部数字设计组工程师。2013年1月27日经公司创立大会选举为股东代表监事，任期为三年。

2、孙建刚先生，1976年出生，中国籍，获山东工程学院电气技术专业学士学位。自2000年起从事集成电路版图设计工作，先后在青岛晶智科技有限公司、上海贝岭矽创微电子有限公司、上海谋胜微电子有限公司任集成电路版图设计工程师及部门经理。2011年加入公司，现任公司技术部版图组设计经理。2013年1月27日经公司创立大会选举为股东代表监事，任期为三年。同日经第一届监事会第一次会议选举为监事会主席。

3、梁会锋先生，1984年出生，中国籍，获上海大学学士学位。自2006年起从事集成电路业，历任上海海尔集成电路有限公司产品工程师、上海贝岭矽创微电子有限公司产品工程师、上海谋胜微电子有限公司质量工程部总监。2011

年加入公司，现任公司营运总监。2013年1月27日经公司职工代表大会选举为职工代表监事，任期为三年。

（三）公司高级管理人员

1、陆健先生，公司总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”。2013年1月27日经第一届董事会第一次会议聘任为总经理，任期为三年。

2、张文荣先生，公司副总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。2013年1月27日经第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期为三年。

3、梁东先生，公司副总经理，1966年出生，中国籍，毕业于武汉测绘科技大学（现武汉大学），获学士学位。自2002年起从事集成电路市场销售业，历任珠海南科集成电路有限公司销售部经理、上海矽创微电子有限公司市场总监、上海贝岭矽创微电子有限公司销售经理、上海谋胜微电子有限公司销售总监。2011年加入公司，任销售总监。2013年1月27日经第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期为三年。

4、胡璨女士，公司财务总监，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。2013年1月27日经第一届董事会第一次会议聘任为财务总监，任期为三年。

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

财务指标	2012年度	2011年度
营业收入（元）	46,143,416.00	24,869,382.75
净利润（元）	2,331,775.39	906,642.36
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,211,488.96	878,442.36
毛利率（%）	18.27	13.68
净资产收益率（%）	44.51	31.19
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	42.21	30.22
每股收益（元/股）	1.17	0.45
稀释每股收益（元/股）	1.17	0.45
扣除非经常性损益的每股收益（元/股）	1.11	0.44

经营活动产生的现金流量净额（元）	-606,583.99	-1,203,741.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.60
应收账款周转率（次/年）	3.29	1.81
存货周转率（次/年）	4.63	5.33
财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（元）	31,666,539.01	19,386,930.48
股东权益合计（元）	5,238,711.68	2,906,936.29
每股净资产（元/股）	2.62	1.45
资产负债率（%）	83.46	85.01
流动比率	1.10	1.12
速动比率	0.64	0.87

注：

1、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末股本（实收资本）为基础计算。

2、若按公司整体变更后的股本总额 500 万元计算,则 2012 年度、2011 年度每股收益分别为 0.47 元/股、0.18 元/股；每股净资产分别为 1.05 元/股、0.58 元/股；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.12 元/股、-0.24 元/股。若按公司最新的股本总额 725 万元计算,则 2012 年度、2011 年度每股收益分别为 0.32 元/股、0.13 元/股；每股净资产分别为 0.72 元/股、0.40 元/股；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.08 元/股、-0.17 元/股。

3、由于公司 2010 年底设立,2010 年末应收账款、存货余额均为零。2011 年应收账款周转率、存货周转率计算公式分别为营业收入/应收账款余额、营业成本/存货余额。

4、公司报告期内无纳入合并范围的子公司,归属于申请挂牌公司股东的净利润、归属于申请挂牌公司股东的扣除经常性损益后的净利润、归属于申请挂牌公司股东权益合计三项指标与分别与上表中净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益合计一致。

九、与本次挂牌有关机构

（一）主办券商：广发证券股份有限公司

住 所:	广州市天河北路183-187号大都会广场43层
法定代表人:	孙树明
联系电话:	020-87555888
传 真:	020-87553577
项目小组负责人:	张柯
项目小组成员:	王晶、杨亮亮、姜慧芬

(二) 律师事务所：上海市锦天城律师事务所

住 所:	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
单位负责人:	吴明德
联系电话:	021-61059000
传 真:	021-61059100
经办律师:	杨海峰、程家斌

(三) 会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所:	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5层
单位负责人:	顾仁荣
联系电话:	010- 88095588
传 真:	010- 88091199
经办注册会计师:	徐超玉、汪明卉

(四) 资产评估机构：北京金正元资产评估有限责任公司

住 所:	北京市西城区广内大街6号枫桦豪景A座2门801号
法定代表人:	谢小平
联系电话:	010-63580050
传 真:	010-63580050
经办资产评估师:	谢小平、徐增

(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所:	深圳市深南大道1093号中信大厦18楼
联系电话:	0755-25938000
传 真:	0755-25988122

第二章 公司业务

一、业务情况

(一) 主营业务

2010年11月26日，晟矽微电子成立于浦东张江高科技园区，是一家专业的集成电路设计和销售企业，具体设计和销售的IC产品以微控制器为主，另有少量专用集成电路。公司专注于研发高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型8位MCU产品，用以帮助客户提高系统性能、降低产品开发风险、减少系统总成本以及缩短产品面市时间，并为客户提供相关应用开发工具和整机系统方案。目前公司的主要产品应用从遥控器、锂电、小家电、消费类等领域逐步拓展到智能家居、工业控制、汽车电子等领域。

公司自主研发的MCU芯片及其应用解决方案的开发及产业化项目是基于高可靠、超稳定、标准开放而著称的8051架构及RISC架构技术，符合国家的科技发展战略，也符合行业的发展趋势，并采用业已成熟的半导体集成电路180nm CMOS及130nm CMOS生产工艺进行设计和芯片生产，可以广泛应用于智能民用产品、测控系统、智能仪表、工业控制等领域。目前，用户遍布全国多个省、市、自治区。公司主要的终端客户有九阳股份有限公司、雅乐思电器厂、爱仕达集团有限公司、康佳集团、创维集团等业内知名公司。公司主要以经销商代理销售为主、直接销售为辅的模式销售产品，并与主要经销商建立了稳定合作关系。在整合现有产品技术的基础上，通过现有技术的延伸，公司已开始研制基于物联网架构的智能家居领域产品及创新型电子领域产品。

1. 主要产品

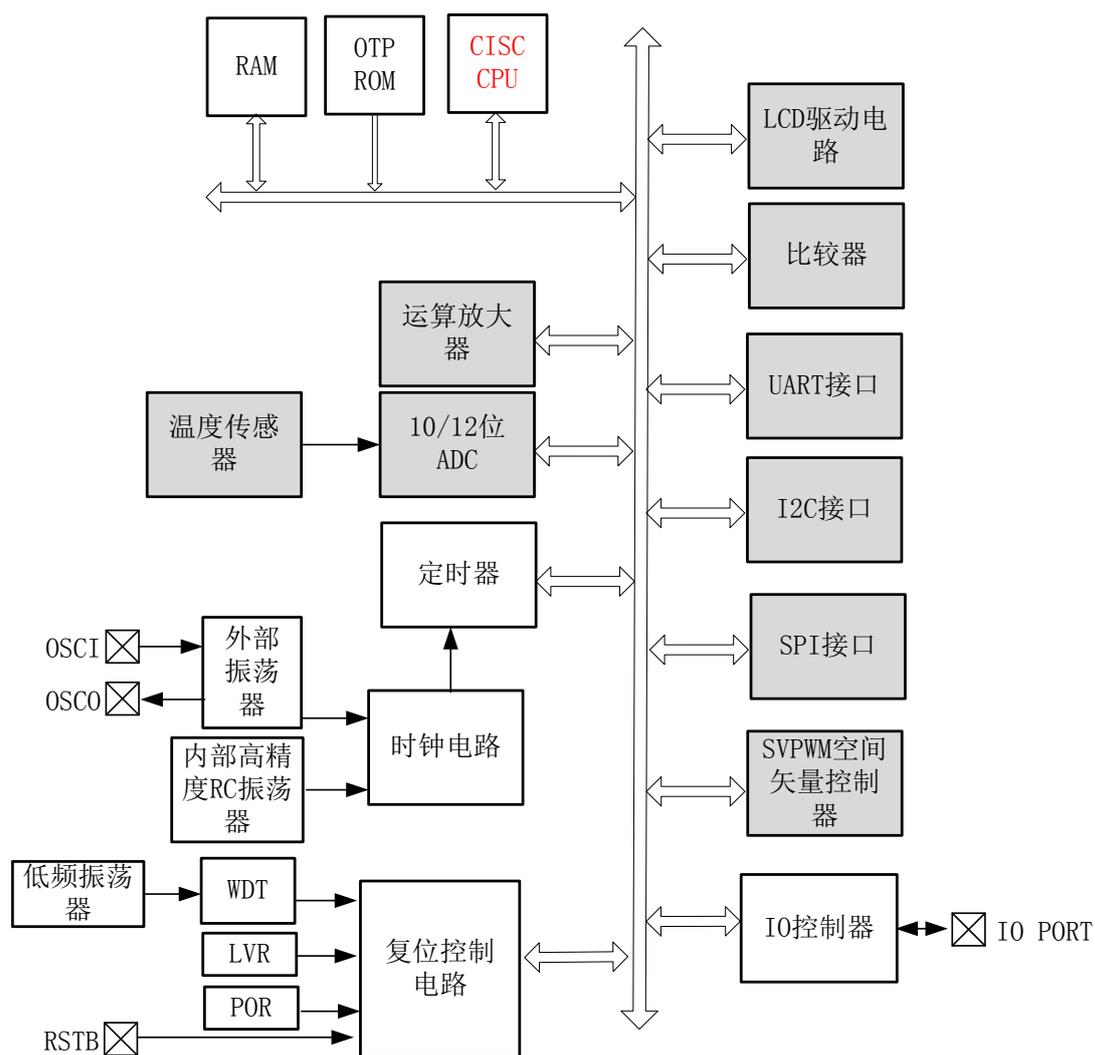
MCU根据应用的范围可以细分为通用型和专用型，专用型特指针对某类产品而专门设计，如专用于洗衣机的MCU等，而通用型单片机又可以根据字长分为4位、8位、16位、32位、64位。目前随着科技进步，对于计算机微处理器而言，8位、16位已经趋于萎缩，主要流行32位、64位，但是对于单片机而言，8位机成本低，易于开发，已经能够满足一般工业领域的大多数应用需求，目前仍然是应用范围最广的单片机，只有在航天、机器人等可能需要高速处理大量数据的高科技领域，才需要使用32位、64位等高数位单片机。

具体而言，公司的产品类型可以分为如下三类：

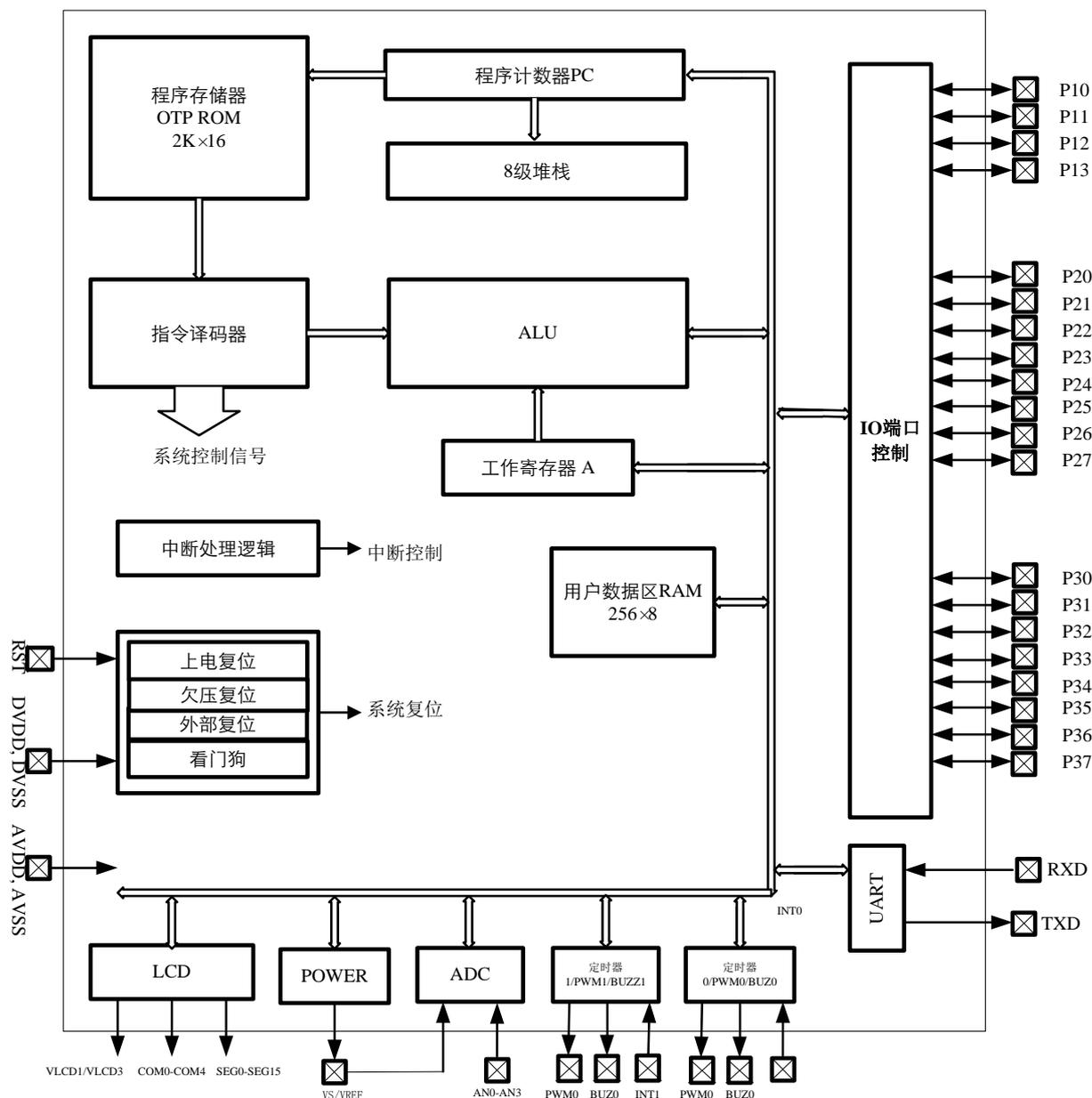
1. 通用类 MCU

目前公司开发的 8 位通用 MCU 产品已初步形成系列化格局，根据采用的系统架构不同可以分为三类，即基于 CISC（复杂指令集）的 MC10/MC20 架构；基于 RISC（精简指令集）的 MC30/MC32/MC33 架构；以及基于 1T8051 的 MC51 架构。

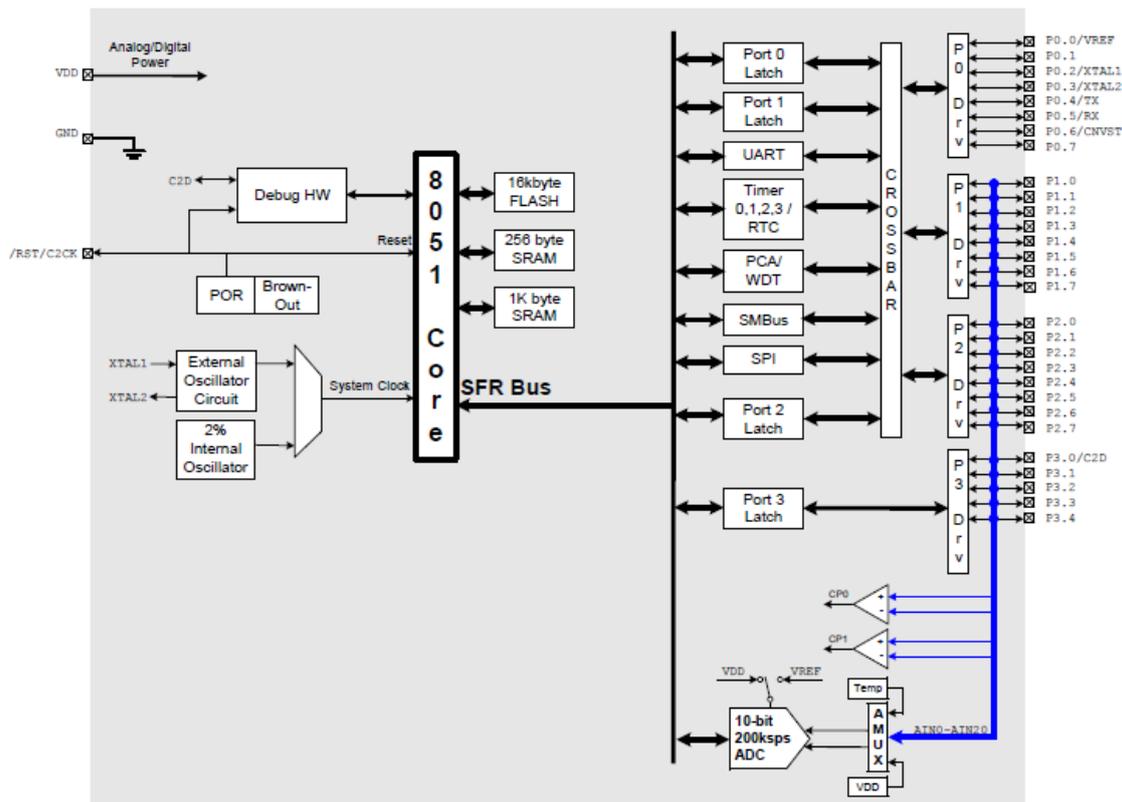
这三类架构产品的示意图如下：



图：MC10/MC20 架构



图：MC30/MC32/MC33 架构



图：MC51 架构

通用类 MCU 系列产品应用领域很广，公司针对不同的应用场合开发了具有不同外设资源的产品，如下表所示：

产品	应用举例
MC20P01、MC20P02B、MC20P04、MC20P801、MC30P011	电风扇、LED 装饰灯、机顶盒面板等
MC20P24B、MC20P22、MC32P21	电饭煲、电压力锅、电动工具、充电器等
MC32P44、MC33P94	DVD 面板、人体秤、厨房秤
MC20P68、MC33P64	小家电触摸开关面板
MC51F332	光通信模块
MC32E22	安防类产品

2. 专用类 MCU

除了以上的通用 MCU 外，公司还根据客户要求定制专用的 MCU 产品。这一类产品除了能完成通用 MCU 可以完成的基本控制功能外，还集成了某一特定应用所必需的功能电路，这样就大大方便了应用，减少了元器件，降低了系统成本，增强了系统可靠性。

比如 MC20P38 就是为电磁炉主控专门研制的专用 MCU,集成了用于检测电压、功率、浪涌信号等的高精度运算放大器和比较器,以及用于调功率的 PPG(功率脉冲调制发生器)模块。

MC10P01、MC10P11 是专门为电视、DVD、机顶盒等遥控器开发的专用 MCU,内部集成了红外发射管驱动电路、高精度振荡电路。MC10P78 和 MC32P716 则在此基础上又增加了红外接收解码电路,用于带学习功能的遥控器。

3. ASIC 产品

公司还开发了一些 ASIC 类产品,作为 MCU 类产品的补充。ASIC,通常是指为专门目的而设计的集成电路,通常针对特定客户需求或者特定电子系统需要而设计制造。ASIC 与 MCU 的最主要区别在于 MCU 通常在实际运用中需要运用专门的编写工具进行二次开发,而 ASIC 已经无需开发可以直接投入使用,因此相对灵活性较差,专用性较强。

公司的 ASIC 产品主要包括如下几种类型:MC9001 用于锂电池编码,MC9002、MC9008 用于加密,MC9003、MC9006 用于计时和电波钟,MC9004、MC9012 用于位移测量,MC9005、MC9009 用于锂电池保护。

从产品应用领域来看,公司 MCU 类产品逐步沿着 8 位通用 MCU、8 位专用 MCU、通信/工控类 MCU、汽车用 MCU 的路线稳步发展。

目前已开发的通用 MCU 包括 MC10P01B、MC10P11B、MC10P02、MC20P01、MC20P02B、MC20P24B、MC20P04、MC20P22、MC30P01、MC32P21、MC10016 等。2013 年预计开发的通用 MCU 包括 MC31P11、MC30P44、MC32P02、MC32T21、MC30T22 等。

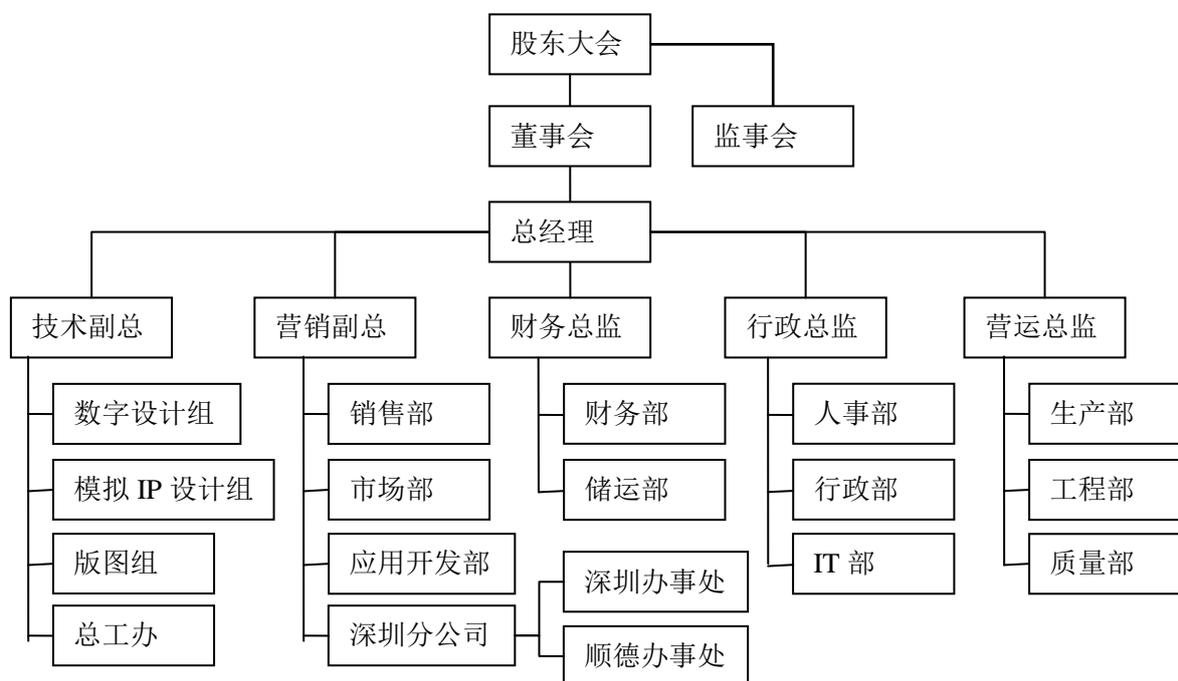
已开发的专用 MCU 包括用于电磁炉的 MC20P38、用于学习型遥控器的 MC10716。今后 2 年预计开发的专用 MCU 有用于触控按键的 MC32P64、MC32T68,用于学习型遥控器的 MC33P78、用于电子秤的 MC33P94 等。拟开发的 MC51F332 属于通信类 MCU、MC51F832 属于变频电机控制类 MCU。

从内核技术上看,用最初的 8 位 CISC 内核(MC10/MC20),逐步过渡到市场认可度更高的 RISC 内核(MC30)和 8051(1T)内核,并计划在工控、变频控制领域开发以 ARM Cortex 系列内核的 32 位 MCU。

从产品使用的工艺平台看,沿着 0.35um OTP 工艺、0.35um MTP 工艺、0.18um OTP 工艺、0.13um/0.18um Flash 工艺逐步发展。

二、公司主要业务流程和方式

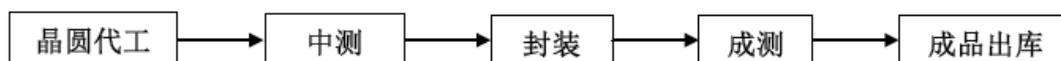
(一) 公司内部组织结构图



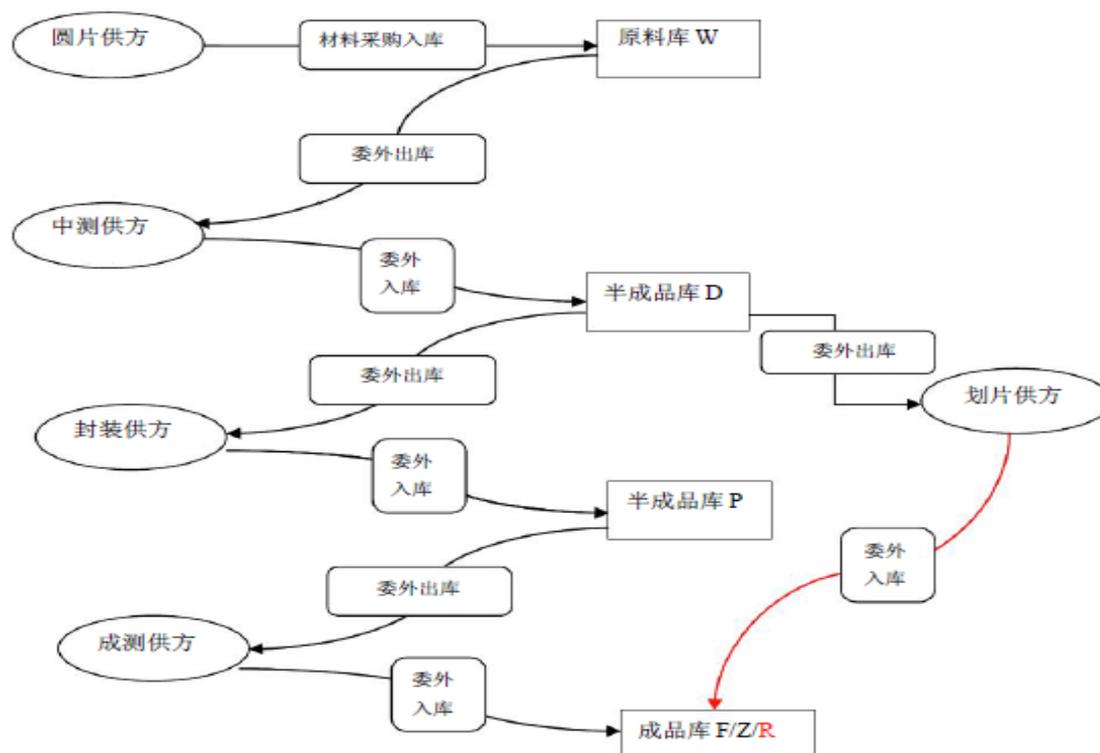
(二) 公司主要生产和服务流程及方式

具体而言，IC 产业链通常由 IC 设计制造、经销商分销及终端电子产品生产制造三个环节构成，IC 设计制造可以进一步分为 IC 设计、晶圆代工、封装测试三个生产环节。晶圆代工指根据委托企业的 IC 设计，将设计刻录在晶圆上，收取代工费。封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品。从生产流程上来看，IC 设计企业根据终端电子产品需求进行集成电路布图设计，并委托上游厂商进行晶圆代工，芯片封装测试，待芯片生产完毕后，交付下游经销商经销或者直接交付终端电子厂商进行应用。由于晶圆加工等上游产业通常需要大量的资金投入进行生产线购买，且产品处于不断升级换代之中，因此属于资本密集型及技术密集型产业，目前国内大部分集成电路设计企业均采用 Fabless 模式（指无生产线模式）进行。

公司的生产工艺流程可以简要概括为：



晟矽微电子也采用了 Fabless 模式进行运营，即将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试外包，专注于集成电路设计产业，符合集成电路垂直分工产业链的特点，也符合国际市场上集成电路设计占整个行业产值比重愈来愈高的趋势发展，同时由于无生产线负担，专注于设计业务，具有灵活性、市场灵敏度高等特点。公司目前主要根据终端产品市场需求，将抽象的产品设计要求转化为特定元器件组合，并在硅片上实现成具体芯片。目前公司已经与上海华虹、天水华天、上海拓芯、华天科技等集成电路上游企业建立了稳定合作关系，向其进行晶圆采购以及委托其进行芯片中测、封装及成测。



图：晟矽微电子生产工艺流程图

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

公司在 MCU 产品设计上具有丰富的经验，并积累了一定的核心技术：

1. 成熟的 MCU 内核

内核是 MCU 产品的核心，完成算术逻辑运算，并对各部件进行统一协调和控制。内核在指令执行效率、抗干扰方面的性能直接决定了 MCU 的品质。公司有三款成熟的、具有自主知识产权的 MCU 内核，涵盖了目前市场应用最广泛的 8 位 MCU 内核的主流架构：

（1）基于复杂指令集（CISC）的 MC10/MC20 内核，这款内核具有指令丰富、编程灵活的特点。此内核在内部将较复杂的指令译码，分成几个微指令去执行，优点是指令丰富，寻址方式多，可设计专用指令执行特殊的任务，因此，开发程序便利，处理特殊任务的效率较高。从处理器架构上说，MC10/MC20 内核属于普林斯顿结构（又称冯·诺伊曼结构），是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的

不同物理位置，因此程序指令和数据的宽度相同，均为 8 位。MC10/MC20 的指令通常是多字节、多周期的。

(2) 基于精简指令集 (RISC) 的 MC30/MC32/MC33 内核，这款内核具有执行效率高、编程简便的特点。此内核保留了 55 或 73 条常用指令，配合内部快速处理指令的电路和流水线结构，加快指令译码和数据处理，优点是指令简单，学习容易，执行速度快。从处理器架构上说，MC30/MC32/MC33 内核属于哈佛结构，使用了两个独立的存储器模块，分别存储指令和数据，每个存储模块不允许指令和数据并存，以便并行处理，也就是说，程序指令宽度为 16 位（或 14 位）而数据宽度为 8 位。指令系统除了程序分支及转移指令是单字节双周期指令外，其他指令都是单字节单周期指令。

(3) 基于 1T8051 的 MC51 内核，这款内核是传统 8051 的增强版，执行速度最高可达到 100MIPS。此内核指令集与传统的 MCS-51 完全兼容，但是采用了流水线的结构，70%的指令执行时间为 1 或 2 个系统时钟周期，是标准 8051 指令执行速度的 12 倍，峰值执行速度可达 100MIPS。MC51 增加了中断源，最多可配置 22 个中断源，可挂载大量的模拟、数字外设。

2. 高精度内置 RC 振荡器

公司研发的高精度内置 RC 振荡器可作为 MCU 或其他 ASIC 集成电路产品的时钟发生器，其振荡频率稳定性高、偏差小，可在绝大部分应用领域内取代外接晶体振荡器，为客户节省成本、提高系统可靠性。振荡器采用双比较器结构，通过比较器产生的信号控制恒流源对电容进行周期性充电，整形后产生矩形的脉冲振荡波形。另外，由一个宽电压范围的稳压电路给双比较结构振荡器供电，保证在外部工作电压波动的情况下，振荡电路仍能保持相对恒定的工作电压。在实际应用时，该 RC 振荡器在工作电压范围 1.8V~5.0V，温度范围-40~85℃条件下的总体偏差小于 1%。

3. T 型按键扫描技术

电视、DVD、机顶盒的遥控器通常有很多按键，需要通过按键扫描电路来识别哪一个键被按下。传统的按键扫描电路都是矩形排列的，因此 N 个引脚最多实现 $N*N/4$ 个的扫描，例如，14 个引脚按传统的按键扫描方式设计，最多可接 49 个按键。公司开发的 T 型按键扫描电路，N 个引脚最多实现 $N*(N+1)/2$ 个按键的

扫描，同样 14 个引脚，最多可接 105 个按键，同时能保证在待机状态下将整个芯片的电流控制在 0.5 μ A 以下。

4. 嵌入式设计技术

所谓嵌入式设计，是指将由分立器件或单独的 IC 实现的功能模块集成到 MCU 电路中，这样可以减少应用系统的器件数，起到降低成本、提高可靠性的目的。嵌入式设计技术关键要解决以下问题：一是在原有 MCU 使用的 CMOS 工艺上设计丰富的功能模块，公司已研发了模数转换器、数模转换器、比较器、LCD 驱动电路、LED 驱动电路、高精度运算放大器、温度传感器、稳压基准源、实时时钟模块、变频控制脉宽调制器、I2C 接口、UART 接口、SPI 接口、USB 接口等为数众多的功能模块；二是在将这些功能模块整合到 MCU 的过程中，必须解决 MCU 逻辑电路和功能模块之间互相干扰的问题，以避免功能失效或者降低功能模块的性能指标，为此在产品设计中采用了屏蔽隔离、滤波、去耦、负载平衡、安全接地、冗余等技术。

5. 高可靠性设计技术

公司的产品多用于家电、工控等领域，应用环境比较恶劣，电磁干扰大，大的静电瞬态电流容易造成电路板和器件损伤，空间电磁辐射及电网波动也会引起电路的误动作，这些在客观上要求所设计出的集成电路产品具有更高的可靠性。公司开发的静电泄放保护电路能够有效的防止静电对芯片的损伤，按照行业标准衡量，ESD（静电释放）指标在 4000V~8000V，Latchup（闩锁效应）指标在 400mA 以上。公司采用的抗电源及输入信号瞬间干扰技术，能够有效提高芯片对空间辐射或电源瞬变的抗干扰能力，EFT（电快脉冲群）指标在 4000V 以上。

6. MCU 开发工具的设计技术

MCU 类产品都需要进行二次开发，即编写软件代码以实现特定的功能，这就需要 MCU 厂商为使用者编译器（用于将源代码转换成 MCU 可识别的机器码）、仿真器（用于调试软件代码）、烧写器（用于将机器码下载到 MCU 里）。公司自主研发集成开发环境（IDE）将代码编辑、编译、仿真调试集成在统一的软件界面中，可支持所有本公司已开发的和未来将要开发的 MCU 产品；公司研制的烧写器可应用于 OTP、EEPROM、Flash 类 MCU，烧写不良率在 500PPM 以下。

公司的核心技术来自公司核心技术团队的自主研发，以及对现有成熟技术的整合应用。公司目前已经就相关自主研发完成的布图设计申请获得了相应的权利证书。

（二）主要无形资产情况

1. 专利技术

截至说明书签署日，公司正在申请两项发明专利，具体情况如下：

发明创造名称	申请人	申请号	申请进度
针对变频电机的控制算法在逆变器的电路实现方法	晟矽微电子、北京大学软件与微电子学院	201210195210.1	2012.7.25 初审合格通知
控制 N 电平逆变器的方法	无锡产学研合作教育基地	201210194703.3	2013.1.16 进入实质审查阶段通知

公司与北京大学软件与微电子学院无锡产学研合作教育基地（以下简称“北大基地”）针对上述两项专利申请权，签署了《合作申请专利协议》。协议约定：双方共同申请此两项专利，公司为第一申请人，“北大基地”为第二申请人；双方拥有该专利的署名权，在不涉及第三方的情况下，双方均可使用该专利，包括公司的关联公司及为完成任务的供应商；对第三方的专利许可或转让须经双方同意；实施或转让该专利的收益，公司与“北大基地”按照 7:3 的比例进行分配；与申请和维持专利相关的费用全部由公司承担。

2. 集成电路布图设计专有权

截至本说明书签署日，公司拥有布图情况：

名称	类型	申请日	首次投入商业利用日	授权日期	授权号	保护期限	获得方式	相关收入（万元）
MC10P01B	集成电路布图设计 登记证书	2012.4.14	2012.3.1	2012.6.8	BS.125004 88.5	2022.2.28	原始获得	186
MC9009	集成电路布图设计 登记证书	2012.4.14	2012.3.1	2012.6.8	BS.125004 87.7	2022.2.28	原始获得	1484
MC10P11B	集成电路布图设计 登记证书	2012.4.14	2012.3.1	2012.6.8	BS.125004 68.0	2022.2.28	原始获得	413
MC20P01	集成电路布图设计 登记证书	2012.4.14	2011.7.1	2012.6.8	BS.125004 67.2	2021.6.30	原始获得	368
MC20P24B	集成电路布图设计 登记证书	2012.4.14	2011.7.1	2012.6.8	BS.125004 66.4	2021.6.30	原始获得	940

MC20P22	集成电路布图设计 登记证书	2012. 4. 14	2012. 1. 10	2012. 6. 8	BS. 125004 65. 6	2022. 1. 9	原始获得	10
MC20P38	集成电路布图设计 登记证书	2012. 8. 14	2012. 3. 20	2012. 10. 12	BS. 125010 62. 1	2022. 3. 19	原始获得	227
MC20P02B	集成电路布图设计 登记证书	2012. 4. 14	2011. 7. 1	2012. 12. 11	BS. 125005 61. X	2021. 6. 30	原始获得	1
MC20P02	集成电路布图设计 登记簿副本	2010. 8. 13	2010. 6. 5	2010. 11. 1	BS. 105005 657	2020. 6. 4	谋胜微电 子转让	107
MC1527	集成电路布图设计 登记簿副本	2010. 8. 13	2009. 9. 22	2010. 11. 1	BS. 105005 665	2019. 9. 21	谋胜微电 子转让	152
MC9001	集成电路布图设计 登记簿副本	2010. 8. 13	2009. 11. 5	2010. 11. 1	BS. 105005 673	2019. 11. 4	谋胜微电 子转让	207
MC9010	集成电路布图设计 登记簿副本	2010. 8. 13	2010. 4. 12	2010. 11. 1	BS. 105005 681	2020. 4. 11	谋胜微电 子转让	406
MC10P02R	集成电路布图设计 登记簿副本	2010. 8. 13	2010. 5. 8	2010. 11. 1	BS. 105005 69X	2020. 5. 7	谋胜微电 子转让	-
MC20P24	集成电路布图设计 登记簿副本	2010. 9. 7	-	2010. 12. 30	BS. 105006 05X	2020. 9. 6	谋胜微电 子转让	247

报告期内上述 14 项布图合计创造收入 4,748 万元,另有与 MC20P801 布图相关的收入约 370 万元,该布图 2012 年底尚未进行布图设计专有权申请,公司于 2013 年 5 月正式递交了相关申请。2011 年和 2012 年主营业务收入合计总额为 71,012,798.75 元,差额部分主要为 ASIC 收入及烧写器、编写器等集成电路工具收入。

根据《集成电路布图设计保护条例》第十二条规定,布图设计专有权的保护期为 10 年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算,以较前日期为准。但是,无论是否登记或者投入商业利用,布图设计自创作完成之日起 15 年后,不再受该条例保护。

公司于 2012 年 5 月 9 日从谋胜微电子处受让 6 项布图设计专有权,并已完成布图权属登记变更,具体转让情况参见:“第四章 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

上述 MC10P01B、MC10P11B 两项布图设计专有权已经于 2013 年 2 月提供给上海浦东生产力促进中心作为其为公司借款进行担保的质押物,贷款期限为 2013 年 2 月 6 日至 2014 年 2 月 5 日,质押期限为借款到期日起 2 年,担保金额为本金 100 万元及其他相关债权、质权费用;MC20P22、MC20P24B、MC20P01、MC10P11B、

MC9009、MC10P01B 六项布图已经质押给中国银行上海浦东分行,用作公司自 2012 年 11 月 30 日起至 2015 年 11 月 30 日止的授信业务合同的质押物,担保金额最高本金余额为 400 万元。

3. 商标情况

截至本说明书签署日,公司拥有的及正在申请的注册商标具体情况:

序号	商标名称	申请号/权利号	申请日期	注册人	核定使用类别	商标有效期
1		9741460	2011. 7. 20	晟矽微电子	第 9 类	审核中
2	晟矽	9662597	2011. 6. 30	晟矽微电子	第 9 类	2012. 9. 7 至 2022. 9. 6

注:商标第 9 类为晶片(锗片);半导体;印刷电路;集成电路;集成电路块;晶体管(电子);电动调节设备;控制板(电);遥控仪器。

上述专利技术、商标权、布图设计专有权由于公司在发展过程中内部研发费用归集、结转不够准确,出于谨慎性原则,发生的相关费用已经于发生当期确认为期间损益,未确认为无形资产。

4. 软件使用权

截至 2012 年 12 月 31 日,公司账面有 2 项软件使用权,均为外购取得,其经审计的账面净值为 309,023.33 元,具体情况如下:

序号	软件名称	取得方式	取得日期	使用期限	预计摊销月数	无形资产净值(元)
1	金蝶软件	购买	2012-7-31	永久使用	60	184,140.00
2	IP 使用权	购买	2012-12-31	永久使用	60	124,883.33

上述知识产权权属清晰,不存在权属方面的法律纠纷。

(三) 业务许可资格或资质情况

报告期内,公司集成电路设计暂不涉及业务许可资格或资质的情况。

(四) 特许经营权情况

报告期内,公司暂不涉及特许经营权的情况。

（五）重要固定资产情况

公司的固定资产主要分为电子设备、办公家具和机器设备三类。截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 83.94%。公司固定资产情况如下：

类别	2012. 12. 31 账面净值 (元)	净值占比 (%)	成新率 (%)	折旧年限 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	14,708.30	0.64	68.73	3	5	31.67
办公家具	41,715.91	1.81	62.73	3-5	5	31.67-19.00
电子设备	2,254,019.21	97.56	84.59	5	5	19.00
合计	2,310,443.42	100.00	83.94			

（六）员工情况

1、员工划分

截至 2013 年 4 月 30 日，公司共有员工 42 人，具体结构如下：

按年龄划分			按专业结构划分			按教育程度划分		
年龄段	人数	占比 (%)	部门	人数	占比 (%)	学历	人数	占比 (%)
30 岁以下	22	52.38	管理人员	5	11.90	本科及以上	29	69.05
31-40 岁	17	40.48	技术研发	16	38.10	大专	9	21.43
40 岁以上	3	7.14	营运销售	21	50.00	高中及以下	4	9.52
合计	42	100.00	合计	42	100.00	合计	42	100.00

2、核心技术人员

（1）核心技术人员概况

张文荣先生，公司股东、董事、副总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

李秀峰先生，公司技术部数字设计组工程师、公司监事，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

莫光锋先生，公司营销部应用开发部副经理，1984 年出生，获上海交通大学电子信息工程专业学士学位。2006 年至 2008 年在上海胜利测试技术有限公司

任电子设计工程师。2008年至2009年在上海贝岭矽创微电子有限公司任系统工程师。2010年在上海谋胜微电子有限公司任工具组主管。2011年加入公司，现任营销部应用开发部副经理。

罗鹏先生，公司技术部模拟IP设计组经理、公司董事，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

孙建刚先生，公司技术部版图组设计经理、公司监事会主席，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）公司监事”。

梁会锋先生，公司营运总监、公司监事，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）公司监事”。

（2）核心技术人员持股情况

公司核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）	在谋胜投资公司的持股占比（%）	间接持股比例（%）
1	张文荣	副董事长、副总经理	150.00	20.69	-	-
2	罗鹏	董事、模拟IP设计组经理	-	-	14.93	4.63
3	孙建刚	监事会主席、版图组设计经理	-	-	5.33	1.66
4	梁会锋	职工代表监事、营运总监	-	-	4.00	1.24
5	李秀峰	监事、数字设计组工程师	-	-	5.33	1.66
6	莫光锋	应用开发部副经理	-	-	4.00	1.24
合计			150.00	20.69	33.59	10.43

谋胜投资公司注册资本为225万元。谋胜投资公司持有晟矽微电子225万股股份，占晟矽微电子注册资本比例31.04%。

最近两年内公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况

(一) 报告期业务收入的主要构成

报告期内公司的业务收入来自集成电路产品销售，其主要情况如下：

项目	2012 年度	占比 (%)	2011 年度	占比 (%)
集成电路产品	46,143,416.00	100.00	24,869,382.75	100.00
合计	46,143,416.00	100.00	24,869,382.75	100.00

晟矽微电子是一家专业从事集成电路技术设计、技术开发、技术测试及销售的供应商。公司的产品主要包括通用类 MCU、专用类 MCU、ASIC 产品及开发工具。目前公司的主要产品应用从遥控器、锂电、小家电、消费类等领域逐步拓展到智能家居、工业控制、汽车电子等领域。报告期内公司收入全部由主营业务收入构成，即集成电路产品收入。报告期内收入呈现快速增长态势，2012 年营业收入较 2011 年同比增长 85.54%。

报告期内公司主营收入的快速增长主要源于公司在 2012 年度加大了研发力度及研发投入，研发出 14 种新产品，其中 6 种新产品已投入生产并实现经济收入，为公司抢占市场先机。公司一方面在加大研发力度研制新产品的同时，对原有产品进行了技术更新及性能强化，进一步扩大市场占有率。另一方面，随着智能家居这一新领域的快速发展为公司的产品提供了更大的增长空间与平台，从而拉动收入的快速增长。

(二) 主要供应商

公司 2011 年度和 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购内容	2011 年度采购额 (元)	占当年采购总额的比例 (%)
1	上海华虹	晶圆	11,374,788.20	40.51
2	上海拓芯	封装、成测	3,634,620.92	12.95
3	天水华天	封装、成测	3,568,187.69	12.71
4	上海贝岭微电子制造有限公司	晶圆	2,016,577.31	7.18
5	西安微电子技术研究所	封装	1,770,755.80	6.31
前五大供应商采购额合计			22,364,929.92	79.65

序号	供应商名称	采购内容	2012 年度采购额（元）	占当年采购总额的比例（%）
1	上海华虹	晶圆	14,987,933.91	28.32
2	谋胜微电子	晶圆、MCU	10,009,885.71	18.91
3	天水华天	封装、成测	10,008,535.84	18.91
4	上海拓芯	封装、成测	5,596,549.60	10.57
5	华天科技	封装、成测	2,744,023.77	5.18
前五大供应商采购额合计			43,346,928.83	81.89

上海华虹挚芯电子科技有限公司，于 2000 年 12 月 20 日成立，注册资本为 1,000 万元，公司的经营范围为：集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。主营业务为电子产品分销和进出口业务，主要提供集成电路产品贸易服务。

上海贝岭微电子制造有限公司，于 2007 年 8 月 13 日成立，注册资本为 4000 万元，公司的经营范围为：集成电路及微电子器件的制造、代加工及技术服务和咨询，销售自产产品。

上海拓芯电子有限公司，于 2010 年 11 月 3 日成立，注册资本为 50 万元，公司的经营范围为：电子产品销售、从事微电子技术领域内的技术开发、技术咨询。主营业务为集成电路封装、测试。

天水华天科技股份有限公司，成立于 2003 年 12 月，2007 年 11 月公司股票（002185）在深圳证券交易所成功发行上市。目前，企业注册资本 40,613 万元，总资产 23.07 亿元。企业主要从事半导体集成电路、MEMS 传感器、半导体元器件的封装测试业务。华天科技为其子公司，位于西安，主要从事集成电路高端封装测试。

西安微电子技术研究所，始建于 1965 年 10 月，主要从事微计算机、半导体集成电路、混合集成电路三大专业的研制开发、批产配套、检测经营，是集计算机与集成电路科研生产为一体并相互配套的专业研究所。

谋胜微电子主要从事集成电路产品设计、制造、销售业务，为公司实际控制人配偶设立的企业。

报告期内公司对前五大供应商的采购额合计占到当期采购额的 80%左右，存在一定的依赖性，这主要是由公司的业务模式决定的。公司采用 Fabless 模式运营，无独立生产线，晶圆生产及封装测试工作均由上游厂商进行，因此对外采购

量较大且集中度较高。其中上海华虹主要提供晶圆给公司，天水华天、上海拓芯、华天科技可以提供芯片封装、测试工作，上述企业均已与公司建立稳定合作关系，同时由于国内圆片生产企业、封装测试企业数量较多、大小规模各具，公司对相关供应商不存在重大依赖关系。

在 fabless 模式下，公司无生产线，通过委外加工进行晶圆生产及芯片封装、测试。上海华虹 NEC 电子有限公司为国内专业晶圆制造厂，上海华虹为其全资子公司，公司现阶段主要通过上海华虹进行晶圆采购，其接到公司订单后下订单给华虹 NEC，华虹 NEC 按照公司提供的晶圆设计数据要求文件进行生产。贝岭微电子自行生产并提供晶圆给公司，谋胜微电子将外购晶圆出售给公司。在晶圆生产完毕后，公司将晶圆发往天水华天、华天科技、上海拓芯等中测、封装、成测供应商，并提供线路图、布图等一套设计数据文件，据此供应商进行相关封装、测试工作。公司与几家供应商建立较为稳定的合作关系，并根据产能、封装形式、价格、交期等综合考虑选择具体供应商。

（三）主要客户

公司 2011 年度和 2012 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度营业收入总额的百分比：

序号	客户名称	销售内容	2011 年度销售额（元）	占当年营业收入的比例（%）
1	谋胜微电子	MCU、ASIC	12,203,527.09	49.07
2	上海华虹	MCU、ASIC	4,847,942.21	19.49
3	中基国威	MCU、ASIC	2,393,732.22	9.63
4	天津滨海鼎芯科技有限公司	晶圆	1,620,444.24	6.52
5	北京赛科世纪数码科技有限公司	MCU	1,503,921.54	6.05
前五大客户销售额合计			24,869,382.75	90.75

序号	客户名称	销售内容	2012 年度销售额（元）	占当年营业收入的比例（%）
1	谋胜微电子	MCU、ASIC	14,115,595.65	30.59
2	上海华虹	MCU、ASIC	13,087,852.51	28.36
3	中基国威	MCU、ASIC	7,138,529.59	15.47
4	深圳市宏盛达科技有限公司	MCU	1,827,031.91	3.96
5	深圳市华茂粤电子有限公司	MCU	1,622,512.30	3.52
前五大客户销售额合计			37,791,521.96	81.90

上海中基国威电子有限公司，于 2007 年 12 月 13 日成立，注册资本为 500 万元，经营范围：计算机软件、硬件及相关周边设备的研发、设计、生产及销售，集成电路、电子产品的研发、设计及销售，系统集成，并提供相关技术的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。主营业务为电子产品、家电产品的电子系统应用方案设计及 IC 代理分销。

天津滨海鼎芯科技有限公司，于 2009 年 10 月 27 日成立，注册资本为 2000 万元，经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备批发兼零售；软件制作；货物及技术的进出口业务。公司的初始产品包括基于 CMOS 技术的驱动各类移动终端和便携个人数码平台的射频集成电路收发器芯片。主要从事晶圆贸易业务。

北京赛科世纪数码科技有限公司，于 2004 年 2 月 5 日成立，注册资本为 2,607.5619 万元，是国内领先的创新型专业智能终端方案提供商和技术服务商。主营业务是专业机顶盒方案开发商及 IC 代理分销。

深圳市宏盛达科技有限公司，于 2005 年 10 月 21 日成立，注册资本为 50 万人民币，电子产品、电子元器件、家用电器、计算机软硬件、网络产品的技术开发与销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。主营业务是电子系统应用开发及 IC 代理分销。

深圳市华茂粤电子有限公司，于 2005 年 7 月 22 日成立，注册资本为 5,000 万人民币，公司的经营范围为：电子产品、计算机周边设备的技术开发与购销；电脑摄像头、手机电池电子设备的生产加工；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务。主营业务是 IC 产品代理分销及 PCB 贴片生产。

报告期内 2011 年、2012 年前五大客户占公司主营业务收入比例分别为 90.76%、81.90%。公司客户集中度偏高，主要与公司的行业特性相关。由于 MCU 产品应用区域广，客户众多，订单零散，通常 MCU 制造企业通过客户资源丰富的经销商进行产品销售。通过经销商进行销售可以充分利用经销商的销售渠道，并且转移了小客户应收账款的坏账风险。

前五大客户中公司对谋胜微电子销售额占比最高，谋胜微电子为公司实际控制人配偶设立的关联企业（具体参见“第四章 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”），由于谋胜微电子在该领域的发展时间较长，与客户建立了一定的长期合作关系，谋胜微电子先行向晟矽微电子采购后再销售给经销商或者终端客户。从 2011 年开始谋胜微电子逐步将客户转移至晟矽微电子，因此晟矽微电子对谋胜微电子的销售收入占比已从 2011 年的 49.07% 下降至 2012 年的 30.59%。

上海华虹作为集成电路产品分销商，从晟矽微电子采购 MCU 产品及专用芯片后直接出售给各类家电厂商，主要用于遥控器、小家电的主控以及锂电池保护板。中基国威向公司采购 MCU 产品及 ASIC 产品，并对相关产品进行二次开发后用于遥控器和家电的主要控制芯片，并出售给九阳、海信等终端家电厂商。公司向深圳市宏盛达科技有限公司提供专用芯片级 MCU 芯片，主要用于锂电池保护板，便携式 DVD，手机周边，移动电源等产品。公司向深圳市华茂粤电子有限公司提供专用芯片后其部分进行二次开发用于自有产品，同时部分直接出售给电池保护板或电池生产厂。北京赛科世纪数码科技有限公司与公司共同合作开发 MCU 定制芯片用于机顶盒控制，并出售给机顶盒制造商。公司于 2011 年向天津滨海鼎芯科技有限公司出售晶圆，其为专业晶圆贸易商。

公司一方面积极加强经销商关系建设，深入与其合作，利用其客户资源拓宽销售网络；另一方面努力拓宽自有的销售渠道，公司已于 2013 年成立深圳分公司，下辖深圳办事处及顺德办事处，深入开发华南地区这一集成电路行业较为发达区域的市场，降低对单个客户的销售占比。

（四）公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

报告期内，除谋胜微电子是公司实际控制人配偶控股的公司（具体参见“第三章 公司治理”之“四、公司独立性”）、中基国威是公司股东刘蕾控股的公司外（具体参见“第四章 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”），公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5% 以上股份的股东均不在上述供应商或客户中任职或拥有权益。

（五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

合同类型	序号	订单日期	订货方/供货方	订单编号	订单金额(元)	已执行比例(%)
销售合同	1	2011/10/27	上海华虹	11S10270261	1,123,839.81	100.00
	2	2011/8/3	上海华虹	11S08030137	1,069,965.00	100.00
	3	2011/4/21	上海华虹	11S04210027B	538,401.05	100.00
	4	2012/6/5	上海华虹	12HD0605140	2,739,011.90	100.00
	5	2012/8/31	上海华虹	12HD0914296	2,035,530.00	92.97
	6	2012/3/19	上海华虹	12HD0319018	1,895,400.00	100.00
	7	2012/4/23	上海华虹	12HD0427072	1,432,900.00	100.00
	8	2012/6/13	上海华虹	12HD0711183	1,414,530.00	100.00
	9	2012/8/29	上海华虹	12HD0830269	1,414,530.00	100.00
	10	2012/10/26	上海华虹	12HD1031358	1,414,530.00	100.00
	11	2012/10/26	中基国威	12HN0515042	1,129,000.00	66.71
	12	2012/11/16	上海华虹	HD20121224012	675,000.00	100.00
	13	2012/10/26	深圳市宏盛达科技有限公司	HD20130319004	626,000.00	100.00
	14	2012/10/26	深圳市晶泰电子有限公司	SZ20130403011	510,000.00	69.49
			合计		18,018,637.76	96.26
采购合同	1	2011/4/14	上海华虹	S1141402	623,200.00	100.00
	2	2012/1/17	上海华虹	S12011701	572,493.68	100.00
	3	2012/5/14	上海华虹	S12051401	530,788.00	100.00
	4	2012/10/26	上海华虹	S12102608	946,614.32	100.00
	5	2012/11/22	上海华虹	S12112203	984,417.50	100.00
				合计		3,657,513.50

截至2013年4月末公司未来待履行的重大业务合同如下：

合同类型	序号	订单日期	订货方/供货方	订单编号	订单金额(元)	已执行比例(%)
销售合同	1	2013/4/18	深圳市宏盛达科技有限公司	SZ20130418001	1,921,630.00	46.72
	2	2013/4/16	深圳市宏盛达科技有限公司	SZ20130416009	1,610,000.00	3.91
	3	2013/4/2	深圳市美莱电子有限公司	SZ20130403011	1,085,280.00	69.16
	4	2013/4/23	深圳市美莱电子有限公司	SD20130423007	857,010.00	32.40
	5	2013/3/11	深圳市宏盛达科技有限公司	SZ20130311011	821,403.00	100.00
	6	2013/2/25	深圳市美莱电子有限公司	SZ20130225002	610,400.00	28.67
	7	2013/3/7	深圳市亨耐电子有限公司	SZ20130417004	560,003.00	0.62
				合计		7,465,726.00
采购合同	1	2013/4/26	上海华虹	S13042401	1,087,500.00	0.00
	2	2013/4/22	上海华虹	S13042201	1,610,793.00	1.32
	3	2013/3/20	上海华虹	S13032001	1,824,893.00	100.00
	4	2013/1/23	上海华虹	S13012302	1,860,526.50	100.00

			合计		6,383,712.50	58.06
--	--	--	----	--	--------------	-------

由于公司产品应用较广，且主要通过经销商销售，因此具有订单较为分散的特点，订单单笔金额不大但客户会根据市场需求循环签订单，因此待履行合同金额相对保持平稳。

五、商业模式

公司目前主要根据终端产品市场需求，设计各类通用型、专用型MCU系列产品及ASIC系列产品，并委托外协单位根据设计数据文件进行加工生产成芯片产品，然后通过经销商分销，出售给如家电厂商、锂电池厂商等终端客户获取收益。公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术（集中在MCU内核及周边功能、开发工具等方面），以及稳定及经验丰富的技术团队。公司无自有生产线，将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试外包，专注于集成电路设计工作。公司采用通过经销商销售为主、直接销售为辅的销售模式，这主要源自集成电路行业本身的特性。IC产品由于种类多，可以应用于广泛的终端行业，客户规模大小不一，通过引入规模较大的经销商，不仅能够增强公司的销售能力，而且通过对经销商进行反馈信息收集，公司能够更全面的掌握市场的变化并分析了解下游市场的需求，从而适时的改变经营战略。

六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征

（一）所处行业概况

1. 所属行业

公司主要从事集成电路产品设计、制造、销售，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754 -2011），公司属于 C3963 集成电路制造业。

2. 所处行业涉及的市场主体

IC产业链通常由IC设计制造、经销商分销及终端电子产品生产制造三个环节构成，IC设计制造可以进一步分为IC设计、晶圆代工、封装测试三个生产环节。具体情况如下：

（1）晶圆代工厂：根据委托代工的IC设计数据文件，用极精密的设备、按照严格的生产流程，刻录在晶圆上，收取代工费。

(2) 封装、测试厂：指将制作好的晶圆进行切割，并封装成为最终的IC产品。

(3) IC设计企业：IC设计企业根据终端电子产品需求进行集成电路布图设计，并委托上游厂商进行晶圆代工，芯片测试封装，待芯片生产完毕后，交付下游经销商经销或者直接交付终端电子厂商进行应用。

3. 产业政策

集成电路产业作为一国的基础性、战略性产业，是很多新兴产业如云计算、物联网、移动互联网的支撑和基础，也是未来我国努力迈向创新型国家的基石。我国党中央及国务院一直高度关注集成电路产业的发展，为集成电路产业提供一系列财政、税务、产业等方面的政策支持，为产业发展创造良好的环境：

2000年6月，国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号，以下简称18号文件)，制定了集成电路产业的核心政策，为21世纪最初10年集成电路的快速发展打下坚实基础，对行业发展具有战略性意义。

2006年3月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。

2008年1月，信息产业部颁布《集成电路产业“十一五”专项规划》，其中对设计业的发展思路是：鼓励设计业与整机之间的合作，加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发，培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业，开发具有自主知识产权的集成电路产品。

2010年10月，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，我国将在“十二五”期间重点发展战略性新兴产业。新一代信息技术产业作为“十二五”重点发展的七大新兴战略性产业之一，其重点包括着力发展集成电路等核心基础产业；同时除了信息技术产业，节能环保、生物产业、新能源、新能源汽车等其余新兴战略性产业将通过下游应用市场的推动，间接带动集成电路产业的发展。

2011年2月，国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号，以下简称4号文件)从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政

策。4号文件明确提出，“继续实施国发18号文件明确的政策，相关政策与本政策不一致的，以本政策为准”，其中对集成电路产业的支持更由设计企业与生产企业延伸至封装、测试、设备、材料等产业链上下游企业，可见2011年4号文件是18号文件的拓展与延伸。由此可见，国家对集成电路产业的政策扶持力度更进一步增强。

2011年12月，工信部发布《集成电路产业“十二五”发展规划》，作为行业发展的指导性文件，对于促进集成电路产业全面、协调、可持续发展具有重要意义。

我国中央政府及各部委制定了一系列涉及集成电路产业的政策，内容涵盖鼓励设计业与整机业之间的合作、加快涉及量大面广IC产品的设计开发、培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业、开发具有自主知识产权的IC产品等等各个方面，为IC企业长期发展铺平了道路。

（二）市场规模

1. 市场容量

全球市场上，MCU产品作为工业控制、汽车、电子消费品等的重要元器件，其市场需求受到终端产品市场的较大影响。受到2008年以来金融危机的影响，许多传统电子产品的市场增速趋于减缓甚至萎缩，2009年全球集成电路市场增速首次出现下滑8.9%。虽然2010年国际国内半导体市场强劲反弹，但2011年受经济不景气的影响，个人传统电脑出货量增速持续放缓，全球半导体产业销售额仅比2010年增长0.4%。但是在传统电子产品产销量增长放缓的同时，移动互联、云计算、物联网、新型医疗电子等新一代信息技术产业迅速成长，尤其智能手机和平板电脑增长格外突出，2011和2012两年持续快速增长，2012年平板电脑的出货量预计将比2011年增长80%，达到1.1亿台，智能手机将增长39%，达到6.8亿部。同时，随着低碳经济的在全球范围内愈加被重视，应用于节能产品、智能电表等的微控制器销量也迅速增长。在平板电脑、智能手机、微机电系统等移动终端和智能终端需求旺盛的带动下，各类应用处理器、移动通信芯片、传感器芯片和能源管理电路等产品市场增速明显，在传统电子市场低迷的情况下显得格外瞩目。

中国市场上，从2000年以来，随着国家出台对集成电路产业的一系列政策支持，中国集成电路产业迈入快速增长期。从2000到2007年中国集成电路产业持续

快速增长，年均增长率达31.3%，虽然在2008和2009两年受到国际金融危机的冲击，连续两年出现负增长，但2010年后产业增速逐渐恢复。总体来看，从2001到2011年，年均复合增长率达23.7%，成为全球集成电路产业增长最快的地区之一。到2011年，中国集成电路产业规模达1572亿元，占全球集成电路市场比重进一步提高到9.8%。集成电路产业的快速增长一方面得益于我国自2010年以来实行的一系列家电及汽车领域的消费促进政策，另一方面，与国际市场类似，智能家电，移动互联，汽车电子等新兴终端市场的快速发展有力的促进了MCU产业的兴盛。此外，根据集成电路的“十二五”规划，预计2015年的集成电路产业规模要在“十一五”基础上取得重大发展，销售收入超过3000亿元，在世界集成电路市场规模占比达到14%，满足国内市场30%的需求。2001-2011年市场情况具体变动参见下图：



图 2001年-2011年我国集成电路销售情况

数据来源：中国半导体行业协会，2011

在集成产业整个产业链快速发展的同时，我国 IC 设计行业表现为整个产业链中发展最为强劲的领域，其占全国IC产业的比重从2001年的5.5%迅速发展至2011年的30.1%。IC设计行业整体销售额从2001年的11.0亿元增长至2011年底的473.7亿元，年均复合增长率达到45.7%，高于全球Fabless行业的12.8%左右的平均增速。国际、国内Fabless行业的增长速度都明显高于整个集成电路行业的增

长速度，凸显了专注于IC设计的Fabless模式具有较强的生命力和竞争力。根据我国集成电路产业的“十二五”规划，我国芯片设计行业未来占全球Fabless的比重将从2011年的16.8%发展到2015年的18%以上，保持乃至超过全球第三位，并培育出一批超过10亿元的大型设计企业，设计水平能达到国际主流的22nm技术。

销售额(亿元)	2001年	2005年	2010年	2011年
IC设计	11.0	124.3	363.9	473.7
芯片制造	27.2	232.9	447.1	486.9
封装测试	161.0	344.9	629.2	611.6

数据来源：中国半导体行业协会，2011

伴随着各类型终端市场的发展，集成电路产业应用领域越来越广，遍布国计民生的各个重要方面，可以大致归纳为网络通信与计算机、IC卡及智能标签、工业控制、汽车电子、消费类电子、其他等六大领域。中国IC产业也已经自主研发出一系列具有高竞争力、高性能的集成电路产品，例如涉及移动通信终端、平板电脑终端、移动互联芯片、智能识别等众多领域的产品。

2. 竞争程度

尽管过去10年我国集成电路市场迅猛发展，但由于起步较晚，技术水平整体仍较落后于国际先进水平，集成电路产品是2011年进口数额最大的产品，在通用CPU、存储器、数字信号处理器等量大面广的通用集成电路方面国内基本还处于空白状态，这些产品基本依赖进口，表明了目前产业的发展速度仍然跟不上国内市场的增速，尤其是核心芯片产品及高端芯片产品与国际市场有着较大技术水平差距。因此欧美、日本等半导体厂商仍占据高端市场的主力地位。台湾厂商和本土厂商在中低端应用市场具有一定价格优势，但由于国内IC设计行业大多规模较小，同质化严重，创新意识不足，尚未能形成重大的研发核心力量与成果或者找准自身定位在细分市场深度耕耘，因此行业内竞争较为激烈。

3. 行业壁垒

集成电路设计行业整体属于技术密集型及资本密集型相结合的行业，研发能力带来的新产品持续开发能力是一个IC企业的核心竞争力，因此存在着一定的进入壁垒，具体如下：

(1) 技术壁垒

MCU产品通常作为下游终端产品的嵌入式组件而存在，一方面需要具有较强的抗干扰、高稳定性、高集成性，本身对MCU产品的性能已经提出了较高的要求，

另一方面，MCU应用领域越来越广，如何不断地进行研发投入，以生产出能适应各种新产业、新产品的功能需求的芯片产品，持续的技术研发积累对企业发展较为重要，这也成为行业内潜在进入者进入IC行业的一大主要障碍。

（2）资本壁垒

由于集成电路行业前期投入研发周期较长，需要投入研发力量较大，因此对公司的资本投入提出了一定要求。同时由于终端产品更新换代较快，IC企业通常需要能够进行持续的研发投入，研发本身具有一定的风险，保有较为雄厚的资金规模才能够有利于企业抵御相关风险。

（3）客户关系壁垒

不同公司的MCU产品通常在嵌入终端产品中需要运用专门的开发工具进行二次开发，不同公司MCU产品在内核及指令集上都具有一定的特殊性，当一家终端厂商选择了一个集成电路供应商后，对集成电路的相关指令集及开发工具的熟悉需要一定的时间，这造成了客户具有一定的产品黏性。更进一步，对于集成电路的主要下游应用行业，如电子消费品业，由于MCU作为电子消费品核心组件，对于产品性能稳定具有关键作用，在选择MCU厂商时，通常经过一定时间的检测或测试，因此更换供应商亦需要成本投入。较高的客户粘性为后进入者造成了另一大障碍。

（4）人才壁垒

作为技术密集型行业，高素质的研发队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一个合格的IC设计人才既要熟悉芯片设计制造，又要熟悉MCU产品配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可。由于我国核心技术及高端芯片技术的整体水平仍然落后于欧美及日本市场，培养或招募一支高素质的团队对于行业潜在进入者将会构成一定阻碍。

（三）行业基本风险特征

1. 行业竞争加剧，研发压力较大

国内IC设计行业大多规模较小，同质化严重，小企业多满足于低端产品的市场开发，缺少战略目标与长远规划，创新意识不足，尚未能形成重大的研发核心力量与成果或者找准自身定位在细分市场深度耕耘，同时由于集成电路技术处

于不断升级中，因此行业内竞争较为激烈，中小企业研发压力较大。通常研发过程中涉及构建较多开发工具如烧写器、仿真器、编译器等，并且需要进行较多调研、测试工作，因此在新产品投入市场前需要较长的研发周期及大量的研发经费，即使研发成功也同样需要面临研发新品未能适应市场需求的风险。

2. 国内整体技术落后，高端人才缺乏

IC 设计行业作为知识密集型行业，对比发达国家和地区，国内有经验的 IC 设计人才相对稀缺，这是造成国内 IC 设计业整体技术基础较弱、水平较低的主要原因，尽管近年来我国 IC 设计行业人员培训力度逐步加大，随着国内技术发展、产业升级，专业设计人员的数量也逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在，现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。

3. 供应链产能缺乏，质量控制有压力

国内 IC 设计行业大部分采取 Fabless 方式，即仅从事 IC 产品的设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。Fabless 模式具有轻便灵活的特点，没有沉重的生产线运营负担，也无需负担芯片生产线昂贵的维护成本，可以专注于技术创新，通过开发业界领先的技术，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，可以专注于自己的核心业务，充分发挥核心竞争力。但随之而来的风险是晶圆生产、芯片封测需要依赖上游企业，由于晶圆加工属于资金及技术高度密集型产业，合适的晶圆代工厂商较少，集中度较高，一方面生产线外包容易出现质量控制风险，另一方面在生产旺季，可能出现供应商产能饱和而无法及时供货的风险。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司的竞争优势

1. 较强的技术应用、整合及创新能力

公司 MCU 产品与主要国内外竞争对手的同类产品相比并不逊色，在工作电压范围、内置振荡器精度等性能上有一定优势，同时集成有温度传感器、空间矢量控制器等很有应用前景的功能模块，与同类产品相比有较强的竞争力。

2. 价格优势

在以往的项目开发过程中，公司已经与上海华虹、天水华天等加工厂商建立了良好的生产业务关系，保证了公司产品的顺利产业化。2012 年随着销售渠道打开，公司加强了与晶圆厂商的深度合作，获得了供货和工艺的支持，采购晶圆

的价格及加工费出现不同程度的下降，主要晶圆采购价格下降幅度多达 19.89%，中测、封装等加工费用也有不同程度的下降。

3. 研发技术优势

目前公司有研发人员 16 名，约占员工总数的 38.10%，技术人员都在集成电路领域从业时间较长，积累了扎实的研究及实践基础。研发的 MCU 经过大批量的验证，具有成熟 MCU 产品的研发能力及项目管理能力。

4. 较稳固的客户关系

公司 MCU 产品目前主要应用于遥控器产品及小家电，公司非常熟悉自己的目标细分市场，并在细分市场上积累了一批客户资源。公司的 3 款 MCU 内核与其他厂商的 MCU 都有一定差异，指令集上有直接的特色。由于 MCU 产品通常需要根据终端产品进行二次开发，公司研制了一套功能完善、性能可靠的 MCU 开发工具，只能用于本公司开发的 MCU 产品上，前期积累的客户已经熟练掌握了公司的指令集和开发工具，这些特性提高了公司的客户黏性。

（二）公司的竞争劣势

1. 公司处于初创阶段，自有品牌认知风险

由于公司成立仅两年多时间，尚处于业务拓展期，下游客户对公司的自有品牌认知度较低，需要一定的时间打开品牌知名度与影响力，与更多的终端客户建立长期稳定合作关系。

2. 产品研发，技术升级方面的风险

集成电路设计行业的主要特点之一是研发周期长、投入大，通常从了解市场需求，到进行可行性研究、产品研发、样品测试、试验生产、投入量产等分为多个阶段，投入生产后还要面临市场接受度不高的风险。同时，近年来集成电路行业的下游新兴产业需求推动了 32 位 MCU 市场的增长，32 位 MCU 的发展可能对 8 位/16 位 MCU 市场有一定的替代性。尽管由于 8 位 MCU 成本低，易于开发，目前仍占据着 MCU 市场最大的份额，短期内 32 位难以替代它成为市场主流，但长期内公司仍然面临着行业技术不断升级，需要不断加大研发投入及研发的新产品能否为市场所接受的风险。

3. 公司目前融资渠道相对较少，资金周转紧张

公司为一家中小型企业，无自有生产线，无法通过固定资产抵押等途径获得银行贷款。公司为发展自身核心技术，需要拓展企业融资渠道以加大对技术

部、销售团队的资金支持。公司目前主要融资渠道来自于企业自有资本金的积累和银行贷款，发展受到融资渠道的制约。

（三）未来竞争策略及应对措施

未来随着新兴战略性下游产业的发展，集成电路行业面临着诸多发展机遇，公司将牢固树立创新意识，加强市场调研，建立快速反应机制，专注于细分市场及产品创新。

公司目前主要经营8位MCU产品且主要面向遥控器、家电产品等终端领域，在整个MCU产业链中，公司产品主要面向中低端应用领域，但由于家电、遥控器等本身市场容量巨大，公司在相当长一段时间内仍有广阔的市场空间。同时针对公司目前在竞争中存在的一些不足，公司主要有以下几方面的应对措施：一方面公司未来仍然积极加大研发投入，在8位MCU上继续丰富产品系列，逐步转向开发前景广阔的32位MCU，针对新的应用领域如智能家居、物联网、三表（即：水表、电表、燃气表）等拓展新产品，将采取自主研发或合作开发的模式，以填补技术空白，如超低功耗设计、USB3.0、RF、Codec、电力线载波通信等；另一方面，积极谋求资本市场发展，拓宽融资渠道补充资金进行发展，同时通过资本市场进一步树立企业品牌，促进客户开拓。

第三章 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）公司管理层关于三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

有限公司时期，公司制订了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定建立了股东会；未设立董事会，但设一名执行董事；未设立监事会，但设一名监事。公司变更经营范围、变更住所、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵。例如未依照《公司章程》规定按时召开股东会定期会议，档案保管不善，公司部分股东会会议文件缺失等。此外，有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告，有限公司章程也未就关联交易决策程序做出明确规定。

股份公司自成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会的相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《经理人员工作细则》、《财务管理制度》等制度规则。公司的重大事项能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。但由于股份公司成立时间尚短，公司治理运行效果尚待观察。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了技术部、营销部、财务部、行政部、营运部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

（二）公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”规范运作意识，重视加强内部控制制度的完整性及各项管理制度执行的有效性，公司治理依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

股份公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构。公司现有1名法人股东和3位自然人股东，股东人数、资格均符合《公司法》要求。股份公司第一届董事会于2013年1月27日成立，董事会由五人组成，董事长陆健、副董事长张文荣由董事会选举产生。总理由陆健担任，全面负责公司运营。张文荣、梁东出任副总经理，分管技术和营销。胡璨出任财务总监。

股份公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《经理人员工作细则》、《财务管理制度》等内部制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度能够从制度层面保证现有公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东

大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可以依法要求公司收购其股份；

(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利做出了明确规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》第一百三十三条规定了投资者关系管理的相关事宜。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的工作对象、内容、方式、组织及实施等内容做出了具体规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过向公司所在地人民法院起诉解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

4、累积投票制

《公司章程》第八十二条规定了累积投票制的实行状况和程序。公司选举二名以上董事或监事时实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十八条规定了关联股东回避制度。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决。

《公司章程》第一百一十八条规定了董事回避制度。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等内部制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜做出了明确规定。

6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

《公司章程》第三十八条规定，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会对控股股东、实际控制人所持股份建立“占用即冻结”机制，即发现控股股东、实际控制人侵占公司资产后应立即对其所持股份申请司法冻结；凡不能以现金清偿的，通过变现其股权偿还侵占资产。

公司制定了《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《财务报销制度》、《物料报废管理办法》、《仓库管理制度》、《IC 类项目流程管理制度》等一系列规章制度，分别针对管控投资及担保风险，规范关联交易、财务运行、报销付款流程、各类物资产品的报废程序和废品处置、仓库管理和货物调度，以及优化公司的设计开发、产品升级等业务流程事项均进行了具体规定。相应的财务管理和风险控制制度建设已涵盖公司对外投资、担保、研发、采购、生产管理、销售服务等各个环节。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，截至本说明书签署日，公司根据实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

自股份公司设立以来，公司共召开了 2 次股东大会、4 次董事会会议、1 次监事会会议。公司的重大事项能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议和制度能够得到有效执行。但由于股份公司成立时间尚短，公司治理运行效果尚待观察。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人陆健先生最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人陆健先生除控制本公司外，还控制上海谋胜微电子有限公司和上海谋胜投资管理有限公司（详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（四）公司股东相互间的关联关系”）。

上海谋胜微电子有限公司设立于 2008 年 12 月 16 日，注册资本 100 万元，注册号为 310229001339896，注册地址为上海市青浦区青安路 968 号 125 室，经营范围为“电子产品和集成电路领域内的技术设计、技术开发、技术测试，从事货物及技术的进口业务，计算机网络工程（除专项审批），销售集成电路、电子产品、计算机软硬件、电脑耗材、通讯设备。”谋胜微电子是陆健先生的配偶孟媛媛女士和张文荣先生的配偶梅嘉女士出资设立的公司，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	占总股本比例（%）	谋胜微电子任职	备注
孟媛媛	60.00	货币	60.00	法定代表人、执行董事、经理	陆健先生的配偶
梅嘉	40.00	货币	40.00	监事	张文荣先生的配偶
合计	100.00	货币	100.00		

谋胜微电子从 2010 年起开展 MCU 设计制造业务，由陆健先生负责经营管理。晟矽微电子成立后，谋胜微电子逐步转型，从 2011 年下半年起不再进行设计制造，仅作为晟矽微电子针对部分客户的销售渠道，仍由陆健先生管理。孟媛媛女士是谋胜微电子的控股股东、执行董事兼经理，但实际不参与该公司的日常运营；陆健先生与孟媛媛女士为夫妻关系，且从 2010 年起一直负责谋胜微电子的日常管理和经营运作，是谋胜微电子的实际控制人。谋胜微电子已于 2013 年 4 月召开股东会决议关闭。

谋胜微电子 2011 年末和 2012 年末未经审计的总资产分别为 2,046.13 万元和 794.14 万元，所有者权益为 107.10 万元和 77.97 万元。2011 年、2012 年未经审计的销售收入分别为 1,844.69 万元和 1,813.93 万元，净利润分别为 36.50 万元和 -33.02 万元。

（一）业务独立情况

由于集成电路行业本身的特性，公司采用经销商销售为主、直接销售为辅的销售模式。报告期内，谋胜微电子作为公司的销售渠道，二者之间存在较为频繁的关联交易。谋胜微电子从2011年起逐渐将客户转移至公司，且已决议关闭。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、营运、供应、销售部门和渠道，具备面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立情况

公司合法拥有其经营场所的使用权，设备以及商标、专利、集成电路布图设计专有权等知识产权的所有权或申请权等相关权利。

报告期内，公司为上海谋胜微电子有限公司代垫部分员工工资及其他杂项支出，共计 719,868.46 元。

截至本说明书签署日，上述欠款已经清偿完毕。公司资产不存在被控股股东、实际控制人或其控制的其它企业占用的情形。

（三）人员独立情况

截至本说明书签署日，公司董事长兼总经理陆健先生兼任公司法人股东谋胜投资公司的法定代表人、执行董事兼经理；公司监事会主席孙建刚先生兼任公司法人股东谋胜投资公司的监事。除此以外，公司不存在高级管理人员在股东单位中双重任职的情况。

晟矽微电子成立后，原谋胜微电子的主要业务人员劳动关系转移至晟矽微电子，与晟矽微电子签订了劳动合同。报告期内，公司存在部分员工同时分担谋胜微电子的销售、市场、财务、管理等运营职责的情况。谋胜微电子关闭后上述情况得以解决。

公司独立招聘员工，并与全体员工签订了劳动合同；公司制订了独立的劳动、人事、工资管理制度，对员工的工资报酬、福利、社会保险及住房公积金等独立管理。鉴于社保、公积金缴纳和使用的地域因素，2011-2012 年度，公司客户深圳卓瑞芯电子有限公司共为晟矽微电子部分常驻外地工作的员工缴纳了社会保险 61,749.42 元和住房公积金 9,600 元。公司通过货款抵销等形式将相关费用支付给该公司。此外，公司存在未为少数员工缴存公积金的情况。公司已承诺在员

工或主管机关要求时将无条件为未缴纳的员工补缴该等费用，并在深圳设立分公司为派驻深圳等地的员工依法缴纳社会保险和住房公积金。实际控制人陆健先生已承诺对此承担连带责任，并赔偿公司可能遭受的任何损失和责任。

（四）机构独立情况

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，具有健全独立的法人治理结构。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，完全拥有机构设置自主权，并独立行使经营管理职权。报告期内，谋胜微电子与公司存在合署办公的情况。谋胜微电子关闭后，公司不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，公司的财务独立。

五、同业竞争情况

谋胜微电子与公司经营范围相似，同为陆健控制的企业，与公司存在潜在的同业竞争风险。谋胜微电子已于 2013 年 4 月召开股东会决议关闭，同时成立清算委员会展开清算工作，并已于 2013 年 5 月 9 日刊登了注销公告。45 天公告期截至 2013 年 6 月 23 日止，之后谋胜微电子将清偿其全部债务并结算缴纳税款及其他款项。预计谋胜微电子将于 2013 年 7 月完成注销手续。

为避免今后出现同业竞争情形，陆健先生、孟媛媛女士、谋胜微电子出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“一、截至本承诺函出具之日，除谋胜微电子之外，陆健、孟媛媛没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与晟矽微电子相同或类似的业务，亦未投资于任何与晟矽微电子从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，陆健与晟矽微电子不存在同业竞争的其他情形。

陆健、孟媛媛及谋胜微电子承诺在本承诺函出具后 60 日内将谋胜微电子拥有的与晟矽微电子生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益优先出售给晟矽微电子，并保证在本承诺函出具后 90 日内注销谋胜微电子，且谋胜微电子在注销前不再开展与注销无关的经营活动。

二、在陆健作为晟矽微电子实际控制人的事实改变之前，陆健、孟媛媛及谋胜微电子将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与晟矽微电子业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与晟矽微电子从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。

三、无论是由陆健、孟媛媛及谋胜微电子自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与晟矽微电子生产、经营有关的新技术、新产品，晟矽微电子均有优先受让、生产的权利。

四、陆健、孟媛媛及谋胜微电子如若拟出售与晟矽微电子生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，晟矽微电子均有优先购买的权利；陆健、孟媛媛及谋胜微电子承诺自身、并保证将促使其所控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予晟矽微电子的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

五、如晟矽微电子进一步拓展其产品和业务范围，陆健、孟媛媛及谋胜微电子承诺将不与晟矽微电子拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与晟矽微电子拓展后的产品或业务产生竞争的情形，陆健、孟媛媛及谋胜微电子将通过包括但不限于以下方式退出与晟矽微电子的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入晟矽微电子；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护晟矽微电子权益有利的行动以消除同业竞争。

六、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，直至陆健不再为晟矽微电子的实际控制人。

七、如因陆健、孟媛媛及谋胜微电子未履行上述承诺而给晟矽微电子造成损失的，陆健、孟媛媛及谋胜微电子将给予全部赔偿，并承担连带责任。”

谋胜投资公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“一、截至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与晟矽微电子相同或类似的业务，亦未投资于任何与晟矽微电子从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本公司与晟矽微电子不存在同业竞争。

二、在陆健先生作为本公司实际控制人的事实改变之前，本公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）

在中国境内或境外从事与晟矽微电子业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与晟矽微电子从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。

三、无论是由本公司自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与晟矽微电子生产、经营有关的新技术、新产品，晟矽微电子均有优先受让、生产的权利。

四、本公司如若拟出售与晟矽微电子生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，晟矽微电子均有优先购买的权利；本公司承诺自身、并保证将促使本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予晟矽微电子的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

五、如晟矽微电子进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与晟矽微电子拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与晟矽微电子拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司将通过包括但不限于以下方式退出与晟矽微电子的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入晟矽微电子；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护晟矽微电子权益有利的行动以消除同业竞争。

六、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，直至陆健先生不再为本公司的实际控制人为止。

七、如因本公司未履行上述承诺而给晟矽微电子造成损失的，本公司将给予全部赔偿。”

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）关联方占款情况

公司在 2011 年度为上海谋胜微电子有限公司代垫部分员工工资 162,200.00 元，代垫其他杂项支出 235,368.46 元。公司在 2012 年度为上海谋胜微电子有限公司代垫部分员工工资 322,300.00 元。截至本说明书签署日，应收谋胜微电子款项已经全部清偿完毕。

（二）为关联方担保情况

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。截至本说明书签署日，也不存在该等情况。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害股份公司股东利益的行为，股份公司建立了完善的公司法人治理架构，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，在《公司章程》和《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》中对关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限做出了明确的规定。

七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	直接持股 比例 (%)	在谋胜投资公 司的持股占比 (%)	间接持股 比例 (%)
1	陆健	董事长、总经理	250.0000	34.4828	30.8444	9.5724
2	张文荣	副董事长、副 总经理	150.0000	20.6897	-	-
3	于涛	董事	-	-	-	-
4	罗鹏	董事	-	-	14.9333	4.6345
5	胡璨	董事、财务总 监	-	-	5.3333	1.6552
6	孙建刚	监事会主席	-	-	5.3333	1.6552
7	梁会锋	职工代表监 事	-	-	4.0000	1.2414
8	李秀峰	监事	-	-	5.3333	1.6552
9	梁东	副总经理	-	-	2.6667	0.8276
合计			400.0000	55.1725	68.4443	21.2413

谋胜投资公司注册资本为 225 万元。谋胜投资公司持有晟矽微电子 225 万股股份，占晟矽微电子注册资本比例 31.0345%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员均与本公司签订了《劳动合同》和《保密协议》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“一、本人及所控制的其他企业与晟矽微电子最近两年内发生的关联交易均已如实披露于晟矽微电子财务报告中，不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

二、在本人担任晟矽微电子董事/监事/高级管理人员期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与晟矽微电子发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与晟矽微电子签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及晟矽微电子公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。

三、在本人担任晟矽微电子董事/监事/高级管理人员期间，本人保证不通过与晟矽微电子之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害晟矽微电子及其股东合法权益的关联交易。

四、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将对本人位具有法律约束力；如因本人违反上述承诺而给晟矽微电子造成任何损失的，本人将给予全部赔偿。”

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关联关系
1	陆健	上海谋胜投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理	本公司的法人股东

2	孙建刚	上海谋胜投资管理 有限公司	监事	本公司的法人股东
---	-----	------------------	----	----------

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本说明书签署之日，除持有本公司股份外，公司的7名董事、监事、高级管理人员还持有公司法人股东谋胜投资公司的股份（详见下表）。

序号	姓名	职务	对谋胜投资公司出资数 额（万元）	在谋胜投资公司的持股 占比（%）
1	陆健	董事长、总经理	69.4000	30.8444
2	罗鹏	董事	33.6000	14.9333
3	胡璨	董事、财务总监	12.0000	5.3333
4	孙建刚	监事会主席	12.0000	5.3333
5	李秀峰	监事	12.0000	5.3333
6	梁会锋	职工代表监事	9.0000	4.0000
7	梁东	副总经理	6.0000	2.6667
合计			154.0000	68.4443

此外，报告期内陆健先生的配偶孟媛媛女士是谋胜微电子的法定代表人、执行董事兼经理，持股比例60%。张文荣先生的配偶梅嘉女士是谋胜微电子的监事，持股比例40%。

除以上披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。谋胜微电子关闭后，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司不存在利益冲突情况。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

(一) 董事

自2010年11月有限公司设立时起，陆健先生一直担任公司的执行董事兼总经理。2013年2月18日有限公司整体变更为股份公司后，根据相关法律规定，公司设立董事会，公司董事会成员结构合理，除陆健外新增加四名董事：张文荣、于涛、罗鹏、胡璨。

（二）监事

自2010年11月有限公司设立时起，张文荣一直担任有限公司监事。2013年2月18日有限公司整体变更为股份公司后，公司设立监事会，监事会成员包括：孙建刚（监事会主席）、李秀峰、梁会锋（职工代表监事）。

（三）高级管理人员

报告期内，陆健先生一直担任有限公司的总经理。2013年2月18日有限公司整体变更为股份公司后，公司的高级管理人员包括：陆健（总经理）、张文荣（副总经理）、梁东（副总经理）、胡璨（财务总监）。

第四章 公司财务

一、最近两年的审计意见及主要财务报表

（一）最近两年的审计意见

公司2011年度、2012年度财务会计报告已经具有证券业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第0029号标准无保留意见的审计报告。

（二）最近两年财务报表

1. 公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

2. 合并财务报表范围

公司在报告期内无纳入合并范围的子公司。

（1）公司最近两年主要的财务报表

资产负债表

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,369,552.44	98,246.08
交易性金融资产		
应收票据		13,700.00
应收账款	14,272,015.59	13,741,245.39
预付款项	567,130.90	102,481.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,855.08	425,981.46
存货	12,249,482.25	4,024,495.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	29,047,036.26	18,406,150.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,310,443.42	980,780.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,023.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,619,502.75	980,780.25
资产总计	31,666,539.01	19,386,930.48

资产负债表续

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,657,500.00	1,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	
应付账款	19,332,389.26	14,996,500.79
预收款项	753,868.37	13,010.48
应付职工薪酬		
应交税费	483,365.70	267,623.44
应付利息		

应付股利		
其他应付款	200,704.00	102,859.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,427,827.33	16,479,994.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	26,427,827.33	16,479,994.19
股东权益：		
实收资本	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	323,871.17	90,693.63
一般风险准备		
未分配利润	2,914,840.51	816,242.66
所有者权益合计	5,238,711.68	2,906,936.29
负债和所有者权益总计	31,666,539.01	19,386,930.48

利润表

单位：元

项 目	2012 年	2011 年
一、营业收入	46,143,416.00	24,869,382.75
减：营业成本	37,714,073.77	21,468,282.86
营业税金及附加	824.79	30,913.66
销售费用	765,734.46	353,212.70
管理费用	4,486,551.24	1,825,632.41
财务费用	193,320.95	9,548.90

资产减值损失	144.00	
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	2,982,766.79	1,181,792.22
加：营业外收入	160,381.91	37,600.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	3,143,148.70	1,219,392.22
减：所得税费用	811,373.31	312,749.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,331,775.39	906,642.36
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,331,775.39	906,642.36

现金流量表

单位：元

项 目	2012 年	2011 年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,573,068.80	10,656,662.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,710.83	189,526.68
经营活动现金流入小计	28,831,779.63	10,846,189.34
购买商品、接受劳务支付的现金	23,367,326.18	9,453,794.85
支付给职工以及为职工支付的现金	2,009,033.10	506,296.63
支付的各项税费	620,391.44	105,636.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,441,612.90	1,984,202.84
经营活动现金流出小计	29,438,363.62	12,049,930.67
经营活动产生的现金流量净额	-606,583.99	-1,203,741.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,496,898.38	1,213,973.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,496,898.38	1,213,973.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,496,898.38	-1,213,973.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,400,000.00
取得借款收到的现金	5,834,334.00	1,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,834,334.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,322,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,045.27	4,430.56
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,959,545.27	4,430.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,874,788.73	2,495,569.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	771,306.36	77,854.17
加：期初现金及现金等价物余额	98,246.08	20,391.91
六、期末现金及现金等价物余额	869,552.44	98,246.08

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				90,693.63		816,242.66	2,906,936.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,000,000.00				90,693.63		816,242.66	2,906,936.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					233,177.54		2,098,597.85	2,331,775.39
（一）净利润							2,331,775.39	2,331,775.39
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,331,775.39	2,331,775.39
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					233,177.54		-233,177.54	
1.提取盈余公积					233,177.54		-233,177.54	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或所有者)的分配								
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增所有者								
2. 盈余公积转增所有者								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,000,000.00				323,871.17		2,914,840.51	5,238,711.68

所有者权益变动表续

单位：元

项 目	2011 年度							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000.00				29.39		264.54	600,293.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	600,000.00				29.39		264.54	600,293.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,400,000.00				90,664.24		815,978.12	2,306,642.36
(一) 净利润							906,642.36	906,642.36

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							906,642.36	906,642.36
(三) 所有者投入和减少资本	1,400,000.00							1,400,000.00
1. 所有者投入资本	1,400,000.00							1,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					90,664.24		-90,664.24	
1. 提取盈余公积					90,664.24		-90,664.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或所有者)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增所有者								
2. 盈余公积转增所有者								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,000,000.00				90,693.63		816,242.66	2,906,936.29

（2）最近两年更换会计师事务所情况

公司最近两年审计报告均由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

二、公司的主要会计政策及会计估计

（一）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（二）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款。

1. 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 10.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2） 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	预付账款的计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）	0.00	0.00	0.00
1-2年	20.00	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但个别信用风险特征明显不同的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

3. 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(三) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按计划成本计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3	5.00	31.67
办公家具	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第四章 公司财务”之“二、公司的主要会计政策及会计估计”之（六）“非流动非金融资产减值”。

4. 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（五）无形资产

1. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如

为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见之“第四章 公司财务”之“二、公司的主要会计政策及会计估计”之（六）“非流动非金融资产减值”。

（六）非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（七）收入

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠

地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（八）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延

所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（十一）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（十二）主要会计政策、会计估计的变更

公司在报告期内未发生主要会计政策和会计估计的变更。

（十三）重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

3. 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

4. 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1. 公司最近两年的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2012 年度	占比	2011 年度	占比
集成电路产品	46,143,416.00	100%	24,869,382.75	100%
合计	46,143,416.00	100.00%	24,869,382.75	100.00%

报告期内公司收入全部由主营业务收入构成，即集成电路产品收入。公司的收入确认方式为：按照销售商品收入确认标准确认收入，即按照发货签收数量确认收入，该确认原则符合收入的一般确认原则：公司在已将产品的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

报告期内收入呈现快速增长态势，2012 年营业收入较 2011 年同比增长 85.54%。报告期内公司主营收入的快速增长一方面源于行业经验及客户资源的积累，以前采购谋胜微电子产品的客户转由直接向晟矽微电子采购产品。另一方面源于公司在 2012 年度加大了研发力度及研发投入，研发出 14 种新产品，其中 6 种新产品已投入生产并实现经济收入，为公司抢占市场先机。公司在加大研发力度研制新产品的同时，对原有产品进行了技术更新及性能强化，进一步扩大市场占有率。另外随着智能家具这一新领域的快速发展为公司的产品提供了更大的增长空间与平台，从而拉动收入的快速增长。

公司最近两年的主营业务毛利情况如下：

产品	2012 年			2011 年		
	收入（元）	成本（元）	毛利率	收入（元）	成本（元）	毛利率
集成电路产品	46,143,416.00	37,714,073.77	18.27%	24,869,382.75	21,468,282.86	13.68%
合计	46,143,416.00	37,714,073.77	18.27%	24,869,382.75	21,468,282.86	13.68%

报告期内公司毛利率逐年上升，主要原因是相对稳定的销售价格和采购成本的有效控制。随着 2012 年度大量新产品投入市场，为公司抢占先机的同时也为

公司获得了可观的利润，从而带动毛利率的持续上升。与此同时，公司对原有产品的技术更新使得原有产品的售价可以保持在相对稳定的水平，从而起到了稳定毛利率的作用。另一方面，2012年公司采购晶圆的价格及加工费出现不同程度的下降，主要晶圆采购价格下降幅度多达19.89%，中测，封装等加工费用也有不同程度的下降。主要原因是随着公司的发展壮大，产能不断提升，公司的采购议价能力得以提高，使得晶圆采购价格及加工费相应下降。

2. 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2012年度	2011年度	增长率
营业收入	46,143,416.00	24,869,382.75	85.54%
营业成本	37,714,073.77	21,468,282.86	75.67%
营业利润	2,982,766.79	1,181,792.22	152.39%
利润总额	3,143,148.70	1,219,392.22	157.76%
净利润	2,331,775.39	906,642.36	157.19%

报告期内，公司营业收入呈现快速增长态势，2012年营业收入与2011年相比，增长比率高达85.54%。毛利率同时保持逐年上升，从2011年的13.68%上升至2012年的18.27%，因此使得报告期内营业利润，利润总额以及净利润三项指标都保持可观的增长速度。

（二）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2012年度		2011年度		增长率
	金额	占比	金额	占比	
销售费用	765,734.46	1.66%	353,212.70	1.42%	116.79%
管理费用	4,486,551.24	9.72%	1,825,632.41	7.34%	145.75%
财务费用	193,320.95	0.42%	9,548.90	0.04%	1,924.54%
合计	5,445,606.65	11.80%	2,188,394.01	8.80%	148.84%

注：上表中“占比”系指费用项目金额占当期营业收入的比例。

公司2011年、2012年销售费用分别为353,212.70元、765,734.46元，占营业收入的比重分别为1.42%、1.66%，主要是因为公司2012年加强市场开拓力度，2012年营业收入较2011年增长85.54%，同时公司加大了销售团队的建设，销售人员工资费用增长，使得销售费用出现较大幅度的增加。

公司管理费用主要系职工薪酬、房屋租赁费、办公费、费用化的研发费用等。公司 2012 年的管理费用与 2011 年相比，同比增长 145.75%，主要源自研发费用的大幅增加，公司 2012 年加大了研发力度与研发投入，使得 2012 年研发费用与 2011 年相比增加 2,579,828.98 元，增幅高达 83.79%。研发费用的增长主要系人员工资约增长 97 万元、折旧费用增长约 32 万元、研发咨询测试费用约 80 万元等所引起的。

公司财务费用主要系银行借款利息，2012 年财务费用较 2011 年出现增长，主要系因为借款增加。2012 年末与 2011 年末的借款余额分别为 465.75 万元、110.00 万元，增加 355.75 万元。因此使得财务费用的借款利息增加。

公司总的费用支出占营业收入的比重报告期内略有上升，但整体水平较为稳定，费用配比情况基本合理。

（三）非经常性损益情况

单位：元

项目	2012 年	2011 年
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,251.76	37,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	2012年	2011年
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,130.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	160,381.91	37,600.00
所得税影响额	40,095.48	9,400.00
合计	120,286.43	28,200.00

报告期内计入非经常性损益的项目主要为各类政府补助。具体如下：2011年及2012年收到张江高科技园区孵化企业房租补贴37,600.00元、109,900.00元；2012年收到浦东新区企业职工职业教育经费补贴1,851.76元，研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴9,500.00元，上海张江高科技园区科技创新专项资金展位费补贴9,000.00元。

公司2011年及2012年的净利润分别为906,642.36元、2,331,775.39元，扣除非经常性损益后的净利润为878,442.36元、2,211,488.96元。该类非经常性损益不具备持续性，公司不存在对非经常性损益依赖的现象。

（四）适用税率及主要财政税收优惠政策

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
所得税	应纳税所得额	25%
城市建设维护税	实际缴纳的流转税额	1%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
河道维护工程管理费	实际缴纳的流转税额	1%

2. 税收优惠

公司报告期内未享受税收优惠。

根据财政部发布的《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司于2012年12月18日取得工业和信息化部颁发的集成电路设计企业认定证书，证书编号为工信部电子认0524-2012S。截至本说明书签署日，公司已向税务局申请自2011年起享受“二免三减半”的税收优惠，尚在批复中。

四、公司最近两年主要资产情况

（一） 应收账款

单位：元

类别	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,272,159.59	144.00	13,741,245.39	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,272,159.59	144.00	13,741,245.39	-

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	坏帐准备	余额	坏帐准备
1年以内（含1年）	14,271,439.59	-	13,741,245.39	-
1-2年（含2年）	720.00	144.00		
2-3年（含3年）				
3年以上				
合计	14,272,159.59	144.00	13,741,245.39	-

公司报告期内应收账款余额基本保持稳定。公司2011年末，2012年末应收账款余额分别为13,741,245.39元，14,272,159.59元，增长3.85%，主要是由于销售增长所引起的应收账款余额增加。

2011 年末，2012 年末应收账款余额占营业收入的比重分别为 55.25%和 30.93%。应收账款余额占营业收入的比重呈现下降的趋势，主要原因在于对关联方上海谋胜微电子有限公司的应收账款余额降低所致。

截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2011 年 12 月 31 日			是否关联方
	金额	账龄	占应收账款总额的比例	
上海谋胜微电子有限公司	12,001,855.59	1 年以内	87.34%	是
北京赛科世纪数码科技有限公司	940,500.00	1 年以内	6.84%	否
上海华虹攀芯电子科技有限公司	407,813.40	1 年以内	2.98%	否
上海中基国威电子有限公司	135,341.70	1 年以内	0.98%	否
佛山市顺德区星原电子实业有限公司	114,977.40	1 年以内	0.84%	否
合计	13,600,488.09		98.98%	

截止 2012 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2012 年 12 月 31 日			是否关联方
	金额	账龄	占应收账款总额的比例	
上海谋胜微电子有限公司	6,562,929.81	1 年以内	45.98%	是
上海华虹攀芯电子科技有限公司	3,312,505.79	1 年以内	23.21%	否
深圳市宏盛达科技有限公司	1,030,369.33	1 年以内	7.22%	否
深圳市华茂粤电子有限公司	897,205.10	1 年以内	6.29%	否
上海中基国威电子有限公司	789,659.60	1 年以内	5.53%	否
合计	12,592,669.63		88.23%	

公司期末应收账款前 5 名余额账龄均在一年以内，应收账款周转率基本保持稳定，应收账款回收情况较好。

2012 年 12 月 31 日，上海谋胜微电子有限公司、上海晟矽微电子有限公司作为甲、乙方与祺烁半导体（上海）有限公司、深圳市华茂粤电子有限公司、深圳市卓锐思创科技有限公司分别签订三方债权债务转让协议，分别就其各自对上海谋胜微电子有限公司的债务 118,938.58 元、447,839.29 元、533,581.76 元转让

给上海晟矽微电子有限公司，用于清偿上海谋胜微电子有限公司对上海晟矽微电子有限公司的等额债务。上述三方债权债务转让协议涉及金额共计 1,100,359.63 元，抵销后晟矽微电子应收上海谋胜微电子有限公司的金额为 5,462,570.18 元。

(二) 预付账款

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比
1 年以内（含 1 年）	567,130.90	100.00%	102,481.76	100.00%
合计	567,130.90	100.00%	102,481.76	100.00%

截止 2011 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2011 年 12 月 31 日			是否关联方
	金额	时间	未结算原因	
上海张江（集团）有限公司	41,251.39	1 年以内	合同尚未履行	否
上海赛博展览广告有限公司	33,288.00	1 年以内	对方尚未发货	否
上海联慧电子有限公司	20,000.00	1 年以内	对方尚未发货	否
上海张江物业设施管理有限公司	3,672.37	1 年以内	合同尚未履行	否
深圳博莱特电器有限公司	2,025.00	1 年以内	对方尚未发货	否
合计	100,236.76			

截止 2012 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2012 年 12 月 31 日			是否关联方
	金额	时间	未结算原因	
上海隽善电子科技有限公司	163,579.81	1 年以内	对方尚未发货	否
上海联慧电子有限公司	100,000.00	1 年以内	对方尚未发货	否
广发证券股份有限公司	100,000.00	1 年以内	合同尚未履行	否
中瑞岳华会计师事务所	56,603.77	1 年以内	合同尚未履行	否
汇业兴邦投资发展有限公司	43,784.91	1 年以内	合同尚未履行	否
合计	463,968.49			

2012 年末预付账款前五名占期末余额的比重为 81.81%。2012 年末公司预付账款除预付汇业兴邦投资发展有限公司的房租外，预付广发证券股份有限公司及

中瑞岳华会计师事务所为预付咨询费用；预付上海隽善电子科技有限公司、上海联慧电子有限公司为采购款。

(三) 其他应收款

单位：元

类别	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	588,855.08		425,981.46	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	588,855.08		425,981.46	

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	坏帐准备	余额	坏帐准备
1年以内(含1年)	588,855.08		425,981.46	
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计	588,855.08		425,981.46	

截止2011年12月31日，其他应收款金额前二名情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	
上海谋胜微电子有限公司	397,568.46	1年以内	93.33%	是
备用金	28,413.00	1年以内	6.67%	否
合计	425,981.46		100.00%	

截止2012年12月31日，其他应收款金额前三名情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	

上海谋胜微电子有限公司	484,500.00	1年以内	82.28%	是
员工差旅费借款	74,355.08	1年以内	12.63%	否
胡璨	30,000.00	1年以内	5.09%	是
合计	588,855.08		100.00%	

报告期公司其他应收款账龄均在一年以内。其中应收胡璨款项为备用金，由于对谋胜微电子及胡璨应收款项都是关联方款项，不存在回收风险，且账龄均在一年以内，因此未计提坏账准备。其他应收款的其余款项主要为员工的备用金，差旅费暂借款。

2011年公司为谋胜微电子代垫员工工资162,200.00元，代垫其他杂项支出235,368.46元，形成2011年末其他应收款余额397,568.46元；2012年为谋胜微电子代垫部分员工工资322,300.00元，同时偿还代垫杂项支出235,368.46元，因此形成2012年期末余额484,500.00元，该部分全部为代垫工资。

公司为谋胜微电子代垫员工工资的原因是晟矽微电子成立后，原谋胜微电子的主要业务人员劳动关系转移至晟矽微电子，与晟矽微电子签订了劳动合同。报告期内，公司存在部分员工同时分担谋胜微电子的销售、市场、管理等运营职责的情况，因此为了便于操作与管理，工资由晟矽微电子统一发放，为谋胜微电子提供劳务的部分，由谋胜微电子承担。

(四) 存货

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,398,146.13		1,398,146.13	976,193.30		976,193.30
库存商品(产成品)	5,842,425.38		5,842,425.38	1,149,842.20		1,149,842.20
委托加工物资	5,008,910.74		5,008,910.74	1,898,460.04		1,898,460.04
合计	12,249,482.25		12,249,482.25	4,024,495.54		4,024,495.54

公司存货由原材料、库存商品及委托加工物资构成，原材料主要包括采购的晶圆，委托加工物资是指处于中测、封装、成测等不同加工阶段的半成品。2012年末存货余额较2011年末增加8,224,986.71元，增长204.37%。其中原材料增加421,952.83元，增长43.22%；库存商品增加4,692,583.18元，增长408.11%；

委托加工物资增加 3,110,450.70 元, 增长 163.84%。存货的增长主要是由于销售收入的增长所带动, 公司增加了存货保有量以满足未来的销售需要。

公司采用 Fabless 的模式进行运营, 即将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试外包, 产品的加工周期通常需要 2-3 个月, 公司至少需要保有 2-3 个月的销售库存。由于横跨春节期间, 且管理层预计 2013 年的销售收入会呈现快速增长, 因此公司的存货保有量保持约在 3 个半月左右的销量, 引起存货余额大幅增长。根据 2013 年一季度的销售情况, 前三个月的未经审计销售收入约 1,000 万, 成本约 820 万。截至本说明书签署日, 2012 年末的存货已经全部消耗, 与管理层的预期基本符合。因此存货的保有量基本合理, 且可以正常消化, 不存在积压风险。

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司存货状况良好, 未发现减值迹象, 因此未对存货计提跌价准备。

与行业同类上市公司中颖电子(300327)及全国中小企业股份转让系统挂牌公司奥贝克(430188)比较:

	2012 年				2011 年			
	存货余额	跌价准备	占比	存货周转率	存货余额	存货跌价准备	占比	存货周转率
中颖电子	64,095,564.65	2,105,057.20	3.28%	2.58	62,361,447.28	1,413,305.23	2.27%	3.43
奥贝克	6,695,406.56	-	0.00%	2.52	3,114,030.92	-	0.00%	2.65
晟矽微电子	12,249,482.25	-	0.00%	3.08	4,024,495.54	-	0.00%	5.33

注释: 上表中存货周转率计算均用当期营业成本/期末存货余额

从行业同类公司情况看, 存货跌价准备占存货余额的比重较低, 整个行业中存货跌价的风险较低。从公司实际情况看, 首先公司的存货周转率高于行业内的样本公司, 存货滞销的风险相对较低; 其次公司报告期内的毛利逐年上升且均为正毛利, 因此未出现明显的存货跌价迹象; 最后公司期后的实际销售情况, 公司 2012 年末的存货已经全部消耗, 不存在积压风险。公司未对存货计提跌价准备是合理且符合谨慎性原则。

(五) 固定资产

固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	3	5.00	31.67
办公家具	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	5	5.00	19.00

固定资产分类明细如下：

单位：元

2012 年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	13,281.90	8,117.96		21,399.86
办公家具	58,253.42	8,242.56		66,495.98
电子设备	966,049.24	1,698,480.90		2,664,530.14
合计	1,037,584.56	1,714,841.42		2,752,425.98
2011 年度				
机器设备		13,281.90		13,281.90
办公家具		58,253.42		58,253.42
电子设备		966,049.24		966,049.24
合计		1,037,584.56		1,037,584.56

固定资产累计折旧构成情况如下：

单位：元

2012 年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,971.48	4,720.08		6,691.56
办公家具	5,260.56	19,519.51		24,780.07
电子设备	49,572.27	360,938.66		410,510.93
合计	56,804.31	385,178.25		441,982.56
2011 年度				
机器设备		1,971.48		1,971.48
办公家具		5,260.56		5,260.56
电子设备		49,572.27		49,572.27
合计		56,804.31		56,804.31

固定资产减值准备情况如下：

公司的固定资产主要包括生产经营用机器设备、办公家具及电子设备等。采用直线法计提折旧，残值率 5.00%。公司固定资产主要用于满足日常办公和研发需求，均处于正常使用状况。截止 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产未发现减值迹象，亦未计提减值准备。

固定资产净值构成情况如下：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
机器设备	14,708.30	11,310.42
办公家具	41,715.91	52,992.86
电子设备	2,254,019.21	916,476.97
合计	2,310,443.42	980,780.25

(六) 无形资产

公司的无形资产主要为软件，软件的预计使用年限为 5 年。报告期内的无形资产价值变化如下：

2012 年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计		331,600.00		331,600.00
其中：软件		331,600.00		331,600.00
二、累计摊销额合计		22,576.67		22,576.67
其中：软件		22,576.67		22,576.67
三、减值准备累计金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计		309,023.33		309,023.33
其中：软件		309,023.33		309,023.33

(七) 递延所得税资产

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	36.00	144.00		
合计	36.00	144.00		

公司递延所得税资产由计提坏账准备产生的暂时性差异，截止 2012 年 12 月 31 日，计提坏账准备产生的暂时性差异 144.00 元。

(八) 资产减值准备

资产减值准备相关政策请参见“第四章 公司财务”之“二 公司的主要会计政策及会计估计”。

资产减值准备计提情况：

单位：元

项目	期间	期初数	当期计提	当期转回	当期转销	期末数
坏账准备	2012 年度		144.00			144.00
	2011 年度					

五、公司最近两年的重大债务情况

(一) 短期借款

单位：元

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	1,107,500.00	600,000.00
保证借款	3,550,000.00	500,000.00
合计	4,657,500.00	1,100,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日短期借款明细如下：

借款单位	起始日	到期日	年利率	借款金额
郑朝晖	2011.11.30	2012.11.30	-	600,000.00
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	2011.11.22	2012.05.21	12.00%	500,000.00
合计				1,100,000.00

截止 2012 年 12 月 31 日短期借款明细如下：

借款单位	起始日	到期日	年利率	借款金额
中国银行股份有限公司	2012.8.17	2013.02.16	7.56%	1,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2012.7.20	2013.07.19	6.94%	900,000.00
郑朝晖	2012.11.30	2013.11.30	0.00%	600,000.00
安丽萍	2012.12.18	2013.03.07	18.00%	507,500.00

上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	2012. 11. 02	2013. 05. 01	12. 00%	500, 000. 00
上海浦东发展银行股份有限公司	2012. 12. 7	2013. 12. 06	6. 94%	350, 000. 00
浙江泰隆商业银行股份有限公司	2012. 12. 13	2013. 06. 10	8. 50%	300, 000. 00
合计				4, 657, 500. 00

2012年6月，公司与上海浦东发展银行张江支行签订流动资金借款合同，额度为2,500,000.00元，截止2012年12月31日，已取得借款1,250,000.00元，由上海张江中小企业信用担保中心提供保证。本公司股东张文荣、财务总监胡璨分别以其自有房屋建筑物向上海张江中小企业信用担保中心提供反担保。

2012年8月，公司与中国银行上海市浦东开发区支行签订流动资金循环借款合同，额度为2,500,000.00元，截止2012年12月31日，已取得借款1,500,000.00元，由上海谋胜微电子有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣及梅嘉提供最高额保证。

2012年11月，公司与郑朝晖个人签订借款协议，因公司业务发展的需要，向郑朝晖借款600,000.00元，期限为2012年11月30日至2013年11月30日，如果公司无法如期归还借款，则借入方除本金外，还另外需要支付利息，利息按月息百分之一（1%/月）计算。

2012年12月，公司与安丽萍（非关联方）个人签订借款协议，因公司业务发展的需要，向安丽萍借款500,000.00元，其中计提利息7,500.00元，期限为2012年12月18日至2013年3月17日止，为期3个月，借款利率为每月1.5%。

2012年12月，公司与上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司续签最高额循环借款合同，额度为500,000.00元，截止2012年12月31日，已取得借款500,000.00元，由陆健、张文荣、刘蕾、上海谋胜微电子有限公司提供连带责任保证。

2012年12月，公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分所签订流动资金借款合同，额度为1,250,000.00元，截至2012年12月31日，已取得借款300,000.00元，由陈卫杰、陆健、沈歆煜提供最高额保证。

（二） 应付票据

种类	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

截止2012年12月31日，银行承兑汇票余额1,000,000.00元，并缴纳500,000.00元保证金。

(三) 应付账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内(含1年)	19,332,389.26	100.00%	14,996,500.79	100.00%
合计	19,332,389.26	100.00%	14,996,500.79	100.00%

截止2012年12月31日，前5名应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其应付账款总额的比例	
上海华虹擎芯电子科技有限公司	6,967,240.77	1年以内	36.04%	否
天水华天科技股份有限公司	4,643,265.15	1年以内	24.02%	否
上海拓芯电子有限公司	2,186,896.59	1年以内	11.31%	否
上海贝岭微电子制造有限公司	1,048,363.13	1年以内	5.42%	否
上海裕晶半导体有限公司	979,005.86	1年以内	5.06%	
合计	15,824,771.50		81.86%	

报告期公司应付账款余额增加主要系随着销售收入的增长，公司增加采购量，以满足公司经营规模的扩大。

(四) 预收账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内(含1年)	753,868.37	100.00%	13,010.48	100.00%
合计	753,868.37	100.00%	13,010.48	100.00%

截止2012年12月31日，前5名预收账款情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	未结算原因	
上海隽善电子科技有限公司	280,801.50	1年以内	未发货	否
深圳市美莱电子有限公司	249,845.00	1年以内	未发货	否
深圳市麦科器普科技有限公司	200,000.00	1年以内	未发货	否
上海初步电子有限公司	15,517.26	1年以内	未发货	否
宁波卓奥电子有限公司	4,800.00	1年以内	未发货	否
合计	750,963.76			

预收帐款的余额主要为预收货款，其增加主要系销售收入的增长引起的预收货款增加。

(五) 应交税费

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-126,254.53	-15,790.92
营业税		15,000.00
企业所得税	617,859.03	267,590.53
城市维护建设税	-1,290.85	-7.91
个人所得税	797.09	879.19
教育费附加	-6,454.19	-39.54
河道工程修建维护管理费	-1,290.85	-7.91
合计	483,365.70	267,623.44

应付帐款余额 2011 年年底为 14,996,500.79 元,2012 年年底为 19,332,389.26 元; 存货余额 2011 年年底为 4,024,495.54 元, 2012 年年底为 12,249,482.25 元; 2011 年、2012 年的经营活动现金流量均为负数。公司采购处于快速增长, 而且企业的采购支出大于销售收入, 使得进项税额大于销项税额, 引起应交增值税出现负数。

2012 年末应交税费余额比 2011 年末增加 215,742.26 元, 增长 80.61%, 增长的原因主要系企业所得税的增长所致。由于 2012 年度销售收入的增长使得净利润大幅增长, 引起应交企业所得税的余额大幅增加。

(六) 其他应付款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内(含1年)	100,704.00	50.18%	102,859.48	100.00%
1-2年	100,000.00	49.82%		
合计	200,704.00	100.00%	102,859.48	100.00%

截止2012年12月31日,前三名其他应付账款情况如下:

单位：元

单位名称	2012年12月31日				是否关联方
	金额	账龄	款项性质	占其他应付账款总额的比例	
上海中基国威电子有限公司	100,000.00	1年以内	往来款项	49.82%	否
上海尤真电子科技有限公司	100,000.00	1-2年	开发费用	49.82%	否
阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司上海服务三部	704.00	1年以内	往来款项	0.35%	否
合计	200,704.00			100.00%	

截止2011年12月31日,前二名其他应付账款情况如下:

单位名称	2012年12月31日				是否关联方
	金额	账龄	款项性质	占其他应付账款总额的比例	
上海尤真电子科技有限公司	100,000.00	1年以内	开发费用	97.22%	否
宜硕科技(上海)有限公司	2,859.48	1年以内	往来款项	2.78%	否
合计	102,859.48			100.00%	

与中基国威的其他应付款余额为尚未结清的日常往来款。与上海尤真电子科技有限公司为合作开发技术的费用。

六、报告期股东权益情况

单位：元

股东权益	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积		
盈余公积	323,871.17	90,693.63
未分配利润	2,914,840.51	816,242.66
股东权益合计	5,238,711.68	2,906,936.29

2013年1月12日，有限公司召开股东会，一致同意以全体股东作为发起人，以2012年12月31日作为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的中瑞岳华审字[2013]第0029号《审计报告》，截至2012年12月31日，有限公司经审计的账面净资产为5,238,711.68元，将其中的500万元折合股份公司股本500万股，剩余部分238,711.68元计入资本公积。

2013年2月18日，上海市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，公司改制为股份有限公司。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一)关联方及关联关系

关联方	关联关系
陆健	控股股东及实际控制人、董事长、总经理
张文荣	持有公司 5%以上股份的股东、副董事长、副总经理
刘蕾	持有公司 5%以上股份的股东
于涛	董事
罗鹏	董事
胡璨	董事、财务总监
李秀峰	监事
孙建刚	监事会主席
梁会锋	职工代表监事
梁东	副总经理
孟媛媛	陆健先生的配偶
梅嘉	张文荣先生的配偶
赵文博	刘蕾女士的配偶
上海谋胜投资管理有限公司	持有公司 5%以上股份的法人股东
上海谋胜微电子有限公司	报告期内陆健控制的公司
上海中基微电子有限公司	赵文博先生参股并担任法定代表人、董事长的公司
上海中基国威电子有限公司	刘蕾控股的公司

上海谋胜投资管理有限公司的有关情况详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“(四) 公司股东相互间的关联关系”。

上海谋胜微电子股份有限公司的有关情况详见本说明书“第三章 公司治理”之“四、公司的独立性”。

上海中基微电子股份有限公司设立于 2002 年 9 月 5 日，注册资本 100 万元，注册号为 310115000703987，注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-1020 室，经营范围为“计算机软件、硬件及相关周边设备的研发、设计、生产及销售，集成电路、电子产品的研发、设计及销售，系统集成，并提供相关技术的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营。）”赵文博是上海中基的发起人股东之一，持有该公司 25% 的股权，并担任法定代表人、董事长。因未按时参加 2010 年度工商年检，上海中基于 2012 年 5 月 28 日被上海市工商行政管理局浦东新区分局以“沪工商浦案处字[2012]第 150201139158 号”《行政处罚决定书》吊销营业执照。截至本说明书签署日，该公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	曹美珍	25.00	货币	25.00
2	孙亮	25.00	货币	25.00
3	王国勋	25.00	货币	25.00
4	赵文博	25.00	货币	25.00
合计		100.00	货币	100.00

上海中基国威电子有限公司设立于 2007 年 12 月 13 日，注册资本 500 万元，注册号为 310115001048615，法定代表人为苏新文，注册地址为上海市浦东新区金新路 58 号 1911 室，经营范围为“计算机软硬件及外围设备、集成电路、电子产品、家用电器的研发、设计、销售，系统集成，并提供相关的技术咨询服务，从事货物与技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营。）”2010 年 8 月刘蕾成为该公司的控股股东。该公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	刘蕾	440.00	货币	88.00
2	苏新文	35.00	货币	7.00

3	陶慧隽	25.00	货币	5.00
合计		500.00	货币	100.00

(二) 关联交易

1. 偶发性关联方交易

1) 提供担保

2011年11月,公司与上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司签订最高额循环借款合同,额度为500,000.00元,由陆健、张文荣、刘蕾、上海谋胜微电子有限公司提供连带责任保证。截至2011年12月31日,公司在该合同项下借款余额为500,000.00元。2012年12月,公司与上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司续签最高额循环借款合同,额度为500,000.00元,由陆健、张文荣、刘蕾、上海谋胜微电子有限公司提供连带责任保证。截至2012年12月31日,公司在该合同项下借款余额为500,000.00元。

2012年6月,公司与上海浦东发展银行张江支行签订流动资金借款合同,额度为2,500,000.00元,由上海张江中小企业信用担保中心提供保证。公司股东张文荣、财务总监胡璨分别以其自有房屋建筑物向上海张江中小企业信用担保中心提供反担保。截止2012年12月31日,公司在该合同项下借款余额1,250,000.00元。

2012年8月,公司与中国银行上海市浦东开发区支行签订流动资金循环借款合同,额度为2,500,000.00元,由上海谋胜微电子有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣及梅嘉提供最高额保证。截止2012年12月31日,公司在该合同项下借款余额1,500,000.00元。

2012年12月,本公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分所签订流动资金借款合同,额度为1,250,000.00元,由陆健、沈歆煜(非关联方)、陈卫杰(非关联方)提供最高额保证。截至2012年12月31日,公司在该合同项下借款余额300,000.00元。

2) 代垫款项

公司在 2011 年度为上海谋胜微电子有限公司代垫部分员工工资 162,200.00 元,代垫其他杂项支出 235,368.46 元。公司在 2012 年度为上海谋胜微电子有限公司代垫部分员工工资 322,300.00 元。截至本说明书签署日,应收谋胜微电子款项已经全部清偿完毕。

3) 资金往来

公司在 2012 年度公司董事及财务总监胡璨借支 30,000.00 元作为业务备用金,尚未归还。2012 年末公司与中基国威日常往来款项 100,000.00 元已于 2013 年归还。

4) 采购交易

关联方	关联交易类型	2012 年发生额		2011 年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海谋胜微电子有限公司	采购商品	10,009,885.71	18.91	1,732,241.07	6.17
上海中基国威电子有限公司	采购商品	175,429.45	0.33	254,650.00	0.91

与谋胜微电子的采购交易中包括原材料约 608.28 万元、产成品约 214.45 万元、开发用工具约 3.26 万元以及 6 项布图设计约 175 万元。

2. 经常性关联方交易

1) 销售交易

关联方	关联交易类型	2012 年发生额		2011 年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海谋胜微电子有限公司	出售商品	14,115,595.65	30.59	12,203,527.09	49.07
上海中基国威电子有限公司	出售商品	7,138,529.59	15.47	2,393,732.22	9.63

经常性关联交易带来了营业收入及营业利润的增加,向谋胜微电子及中基国威的关联销售为公司 2011 年、2012 年贡献毛利分别为 1,996,905.07 元、3,883,128.68 元,占同期毛利比重分别为 58.71%、46.07%。

报告期内晟矽微电子向谋胜微电子销售的产品,谋胜微电子均已对外实现最终销售。其中,2011 年、2012 年主要销往深圳华茂粤电子有限公司、上海澳肯电子科技有限公司、上海永簧电子有限公司、深圳宏盛达科技有限公司、深圳康特电子有限公司、深圳晶泰电子有限公司、深圳卓锐思创科技有限公司、深圳新

观点科技有限公司等，两年分别向以上客户实现的销售额分别为 592.25 万元、520.58 万元。晟矽微电子、谋胜微电子与上述客户均无关联关系。其余部分商品谋胜微电子通过向零星客户实现了最终销售。谋胜微电子与其客户销售交易按照相关规定签订合同，开具发票，并陆续回收款项。截至本说明书签署日，晟矽微电子销售给谋胜微电子商品发生的货款已全部收回，并已用于偿还谋胜微电子对晟矽微电子的债务，且债务已清偿完毕。目前，谋胜微电子正在办理清算及注销手续。

偶发性关联交易中采购交易是由于谋胜微电子的战略定位及发展规划，谋胜微电子不再进行生产，在逐步转型过渡期间，谋胜微电子将全部存货逐步出让给晟矽微电子。关联方对公司的借款及担保直接及间接的影响公司的现金流量，其中关联方对公司的担保，满足了公司的迅速扩大过程中的资金需求。

(三)关联往来余额

单位：元

项目名称	关联方	2012年12月31日		2011年12月31日	
		账面余额	占该项目总额的比例	账面余额	占该项目总额的比例
应收账款	上海谋胜微电子有限公司	6,562,929.81	45.98%	12,001,855.59	87.34%
应收账款	上海中基国威电子有限公司	789,659.60	5.53%	135,341.70	0.98%
合计		7,352,589.41	51.51%	12,137,197.29	88.32%
其他应收款	上海谋胜微电子有限公司	484,500.00	82.28%	397,568.46	93.33%
其他应收款	胡璨	30,000.00	5.09%		
合计		514,500.00	87.37%	397,568.46	93.33%
其他应付款	上海中基国威电子有限公司	100,000.00	49.82%		
合计		100,000.00	49.82%		
应付账款	上海谋胜微电子有限公司			1,732,241.07	11.55%
应付账款	上海中基国威电子有限公司	29,150.00	0.15%	254,650.00	1.70%
合计		29,150.00	0.15%	1,986,891.07	13.25%

截至 2013 年 6 月 30 日，未经审计的重大关联方余额如下：

项目	关联方	金额
应收账款、其他应收款	上海谋胜微电子有限公司	-

应收账款	上海中基国威电子有限公司	127,237.95
其他应收款	胡璨	30,000.00

(四)关联交易必要性

上海谋胜微电子有限公司系由孟媛媛(本公司实际控制人的配偶)和梅嘉(本公司股东配偶)投资的有限责任公司,于2008年12月16日成立。公司注册资本100.00万元,经营期10年。经营范围主要包括电子产品和集成电路领域内的技术设计、技术开发、技术测试,从事货物及技术的进口业务,计算机网络工程(除专项审批),销售集成电路、电子产品、计算机软硬件、电脑耗材、通讯设备。

谋胜微电子是晟矽微电子业务发展的前身,在行业积累了一定的客户。为了进一步巩固和扩大市场占有率,提高竞争力,出于业务发展的需要,公司股东在起步阶段设立两个业务主体同时运营,即谋胜微电子和晟矽微电子,两家公司分别成立于2008年12月和2010年11月。在2011年上半年以前,两家公司同时运营并分别自产销售。由于存在同业竞争问题,公司股东决定逐步关闭谋胜微电子,并将其客户及业务逐步转移到晟矽微电子。因此2011年下半年及2012年谋胜微电子开始将其全部库存及相关资产逐步转让给晟矽微电子以供其未来经营使用,主要包括原材料、库存商品及6项布图设计。同时,谋胜微电子从2011年下半年开始只作为晟矽微电子部分客户的销售渠道而不自行研发制造。同时,谋胜微电子逐步将原自有资产和客户转移至晟矽微电子的过渡期间,鉴于客户对于谋胜微电子的长期合作关系,部分客户仍通过谋胜微电子采购货物,因此形成了大量的销售交易模式表现为晟矽微电子销售给谋胜微电子,再由谋胜微电子销售给最终客户,该部分销售的是晟矽微电子设计制造的库存商品。随着谋胜微电子正逐步将客户转移至晟矽微电子,因此晟矽微电子对谋胜微电子的销售收入占比已从2011年的49.07%下降至2012年的30.59%。

晟矽微电子向谋胜微电子销售与其向谋胜微电子采购的目的和标的都不同。晟矽微电子向谋胜微电子的采购行为是一次性的,即当谋胜微电子将存货等相关全部销售给晟矽后,即宣告结束。而晟矽微电子通过谋胜微电子对外销售的行为在报告期内多次出现,未来将随着谋胜微电子的关闭而不再发生。

上海中基国威电子有限公司是由晟矽微电子股东刘蕾(在晟矽微电子持股比例 13.79%)控股的公司,主要从事芯片的二次开发。晟矽微电子主要向中基国威销售 MCU 以及专用芯片等产品。中基国威与晟矽微电子的合作模式是中基国威向晟矽微电子采购产品并进行二次开发后,销售给终端客户。由于微电子行业的行业惯例,芯片产品需要经过二次开发后才可以最终使用,满足终端客户的需求。因此晟矽微电子与中基国威的合作模式符合行业惯例与市场需求。报告期内,晟矽微电子主要向中基国威采购 MCU 半成品用于研发,金额较小,该产品与晟矽微电子自行设计制造的产品不同。

公司目前经营规模不大,取得银行信用借款较为困难,一般需由张江中小企业信用担保中心等担保机构提供担保,并由公司股东为担保机构提供反担保;或者由公司股东提供保证担保。

(五)关联交易定价方法及公允性

关联方销售方面,其定价方法与第三方销售价格的制定方法基本一致,为成本加成法。公司在参考市场价格的同时,会考虑客户资信状况、采购数量以及历史上回款情况等指标确定最终销售价格。通过对比第三方销售和关联方销售的商品清单,筛选出相同产品的销售记录以保证价格的可比性,重点选取销售金额较大的商品,公司第三方销售和对关联方销售的价格波动幅度约在 20%以内。关联方采购方面,由于公司股东决定逐步关闭谋胜微电子,并将其全部库存及相关资产逐步转让给晟矽微电子。因此 2011 年度、2012 年度公司按照谋胜微电子的存货历史成本价格,向其购买其全部存货,按照谋胜微电子研发时实际发生的成本向其采购 6 项布图设计,包括掩模板费用、工程流片费用及设计开发费用,共计 175 万元。报告期内公司向中基国威采购用于研发的商品并未向其他供应商采购,无相应的采购价格可比,但是与中基国威销售给其客户的价格保持在同一水平。

综上,公司关联交易的定价具有公允性。

(六)关联交易决策程序执行情况

1. 公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段,公司章程中对关联交易没有相关的规定,按实践操作中的规定经相关负责人审批完成了上述交易。公司整体变更为股份公司以前,对于与关

联公司发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，与非关联公司发生的此类业务决策程序无明显差异。

2. 公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

公司《关联交易管理制度》于 2013 年 1 月 27 日股份公司成立后经股东大会表决通过生效。该制度包括总则、关联方和关联交易的界定、关联交易的原则、关联交易价格的确定与管理、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易的披露以及附则等主要内容。其中关联交易的审议程序中明确规定，公司与关联方之间发生的交易金额低于 300 万元（人民币，下同），或低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的关联交易，由总经理办公会审议批准。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应由董事会审议批准。公司与关联方之间发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易，由公司董事会审议批准。但是，如果出席董事会的非关联董事不足三人的，则应提交公司股东大会审议批准。公司与关联方之间发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

公司按照《关联交易管理制度》要求，“对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交公司审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用相应的规定提交公司审议并披露”，将经常性的关联方购销交易对当年度将发生的日常关联交易总额进行合理预计，根据预计金额由相应的审批机构进行审议，交易价格按照该制度中规定的定价原则，采用市场价格。”

八、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

根据公司股东会决议，晟矽微电子有限公司整体变更为晟矽微电子股份有限公司，由晟矽微电子股份有限公司出资者以其拥有的经审计净资产 5,238,711.68 元认缴，折合 5,000,000 股普通股股份，每股面值 1 元，剩余净资产 238,711.68 元转作资本公积。此次整体变更事项业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具中瑞岳华验字[2013]第 0026 号验资报告。公司已于 2013 年 2 月 18 日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，全体股东一致同意向谋胜投资公司增发股份。

2013 年 1 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程，选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2013 年 2 月 18 日，公司完成了改制的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310115001766129 的《企业法人营业执照》。

2013 年 3 月，谋胜投资公司以货币增资 225 万元，公司注册资本增至 725 万元，此次增资事项已经上海申洲大通会计师事务所审核，并出具了申洲大通(2013)验字第 081 号《验资报告》。

(二) 或有事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的重大或有事项。

九、股利分配政策和最近两年分配情况

(一) 股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）

(二) 最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

十、历次资产评估情况

公司于 2013 年 1 月经北京金正元资产评估有限责任公司进行资产评估，评估基准日为 2012 年 12 月 31 日，并出具了金评报字（2013）第 001 号资产评估报告书用于公司整体变更。根据该资产评估报告，此次评估主要采用资产基础法，评估对象为公司于评估基准日的净资产市场价值，截至 2012 年 12 月 31 日止公司经评估后的净资产为人民币 623.13 万元，比公司经审计净资产价值 523.87 万元高出 99.26 万元，增值率为 18.95%。

十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

公司报告期内无控股子公司，不涉及合并财务报表事项。

十二、风险因素及评估

1、同业竞争风险

报告期内，公司控股股东、实际控制人陆健控制的上海谋胜微电子有限公司与公司存在同业竞争风险。谋胜微电子在行业内积累了一些长期合作的客户，2011 年下半年起仅作为公司针对部分客户的销售渠道，不再进行 MCU 设计制造。谋胜微电子已将其名下的 6 项集成电路布图设计专有权参考历史成本作价转让给公司。为解决与公司的同业竞争问题，谋胜微电子已于 2013 年 4 月召开股东会决议关闭。截至本说明书签署日，谋胜微电子尚未完成注销手续，同业竞争问题的解决仍存在不确定性。

谋胜微电子的股东及实际控制人陆健计划将相关资产和负债进行妥善处理关闭该公司以彻底解决同业竞争问题。此外，陆健、孟媛媛和谋胜微电子出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺今后不再发生类似情况。

2、关联方交易风险

公司在 2011 年、2012 年期间向关联方上海谋胜微电子有限公司销售商品 12,203,527.09 元、14,115,595.65 元，分别占同期营业收入的 49.07%、30.59%；向关联方上海中基国威电子有限公司销售商品 2,393,732.22 元、7,138,529.59 元，分别占同期营业收入的 9.63%、15.47%。2011 年、2012 年公司关联方销售额的合计数分别占同期营业收入的 58.70%、46.06%，关联方销售额占比较高。

同时公司在 2011 年、2012 年期间向上海谋胜微电子有限公司采购商品 1,732,241.07 元、10,009,885.71 元，分别占同期采购金额的 6.17%、18.91%。向

上海中基国威电子有限公司采购商品254,650.00元、175,429.45元,分别占同期采购金额的0.91%、0.33%。2011年、2012年公司关联方采购额的合计数分别占同期采购额的7.08%、19.24%。关联方交易金额重大,公司长期过度依赖关联方会影响公司业务的独立性、市场竞争力以及未来业务的发展壮大。

公司正在着力对谋胜微电子和晟矽微电子的业务进行整合,停止谋胜微电子自产销售的业务,逐步降低晟矽微电子通过谋胜微电子对外销售的占比,并尽快实现相关资产和客户的平稳转移。同时,通过各种渠道在市场上树立晟矽微电子的品牌和知名度,不断提升公司的独立销售能力,以降低关联交易可能带来的不利影响。谋胜微电子已于2013年4月召开股东会决议关闭,与其关联方交易将随着谋胜微电子的关闭而不再发生。中基国威与晟矽微电子的合作模式符合行业惯例,且关联交易金额相对较小,未来可能会继续发生。

3、存货管理的风险

公司2011年末、2012年末存货余额分别为402.45万元、1,224.95万元,存货余额大幅增加。随着公司不断发展壮大,存货的规模会不断扩大,存货管理的重要性和难度同时增加。由于公司采取委托加工的生产模式,部分存货原材料及成品存放于委托加工方,造成公司存在存货管理不当的风险。

公司未来计划逐步健全和完善公司存货管理制度的内部控制,切实加强对存货的管理,避免因管理不善导致存货发生非正常损失。同时,加强对于存放于委托加工方存货的管理力度,通过及时与委托加工方进行对账、对产品委托加工情况进行现场监督等手段,保证存放在委托加工方存货的质量和完整性。对于存货规模扩大的现状,公司将制定存货保有量客观需求的预算,合理保持库存,并通过扩大销售、提高存货管理效率等方式,加快公司存货周转水平。

4、经营活动现金净流出风险

2011年和2012年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-120.37万元、-60.66万元。虽然2012年的经营活动产生的现金流量状况较2011年有所改善,公司报告期内经营活动产生现金流量净额均为负值,表现为现金净流出。如果公司不能有效改善资金周转情况,可能会产生营运资金不足,负债比率提高等风险,进而影响公司的盈利能力。

公司计划做好应收账款的催收工作，控制信用期限，加速资金回流。同时合理利用付款的信用期，确定合理的存货保有量，制定资金使用计划。实时监控现金的收付情况，使得现金收付更加及时顺畅。

5、应收账款金额较大的风险

2011年末和2012年末，公司应收账款净额分别为13,741,245.39元和14,272,015.59元，占当期营业收入的比例分别为55.25%、30.93%，应收账款规模较大。随着业务规模的持续扩张，公司应收账款规模可能持续上升。虽然公司与主要客户建立了较为稳定的合作关系，但公司仍存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，可能对公司经营和业绩将产生不利影响。

公司历来严格执行销售信用政策，注重应收账款的日常管理和到期催收工作。公司要求应收账款专员重点关注超过信用期限的应收账款余额，分析客户超账期回款的原因，做好与客户的沟通工作，并及时向公司总经理反馈信息，由公司加大催款支持力度。要求财务部全力配合业务人员做好催款相关支持工作，定期与客户财务对账，同时充分计提坏账准备。

6、公司处于初创阶段，自有品牌认知风险

由于公司成立仅两年多时间，尚处于业务拓展期，下游客户对公司的自有品牌认知度较低，需要一定的时间打开品牌知名度与影响力，与更多的终端客户建立长期稳定合作关系。

7、委托加工的风险

集成电路产品的生产制作通常从设计开始，通过制造和封装测试等工序最终完成。公司与多数集成电路设计类企业一样，通过委托其他专业芯片制造和封装厂家来完成掩膜制造、芯片制造、电路封装等加工工序。公司在委外加工的过程中，有可能在加工质量、生产数量、加工价格、交货时间等环节存在风险。此外，公司需将芯片设计布图交给加工企业，因此公司的专有技术、工艺等存在技术泄密的风险。

公司拟成立专门的考察小组对委托加工企业进行考评，以确定外包产品合格供方企业的名单。由公司完成原材料的采购，并将原材料提供给委托加工方，根

据双方签订的质量协议、测试协议及加工合同中关于质量的保证条款，对委托加工产品进行质量控制及检测，做好质量监督工作。为保证公司核心技术的专有性，公司应与加工方签订保密协议及加工合同中“技术、保密及专利保护”条款，以确保公司产品核心技术在委托加工过程中不被泄露。

8、产品研发，技术升级方面的风险

集成电路设计行业的主要特点之一是研发周期长、投入大，通常从了解市场需求，到进行可行性研究、产品研发、样品测试、试验生产、投入量产等分为多个阶段，投入生产后还要面临市场接受度不高的风险。同时，近年来集成电路行业的下游新兴产业需求推动了 32 位 MCU 市场的增长，32 位 MCU 的发展可能对 8 位/16 位 MCU 市场有一定的替代性。尽管由于 8 位 MCU 成本低，易于开发，目前仍占据着 MCU 市场最大的份额，短期内 32 位难以替代它成为市场主流，但长期内公司仍然面临着行业技术不断升级，需要不断加大研发投入及研发的新产品能否为市场所接受的风险。

公司未来仍然积极加大研发投入，在 8 位 MCU 上继续丰富产品系列，逐步转向开发前景广阔的 32 位 MCU，针对新的应用领域如智能家居、物联网、三表（即：水表、电表、燃气表）等拓展新产品，以应对行业技术升级面临的风险。

第五章 定向发行

2013年5月3日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让及定向发行的议案》，并授权董事会全权办理公司申请挂牌公开转让及定向发行的有关事宜。

一、拟发行股数

本次定向发行股份不超过 2,500,000 股。

二、拟发行对象范围

本次定向发行的对象为包括上海科技投资公司在内的不超过 5 名新增机构投资者。截至 2013 年 5 月 3 日公司登记在册的股东共 4 名，本次定向发行后公司的股东不超过 200 人。

上海科技投资公司成立于 1992 年 12 月 3 日，注册号为：310000000014404；注册资金为：70,000 万元；住所为：上海市张江高科技园区哈雷路 998 号 4 号楼 104 室；法定代表人为：沈伟国；经营范围为：科技产业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。]经营方式为：投资，开发，服务。上海科技投资公司与上海晟矽微电子股份有限公司及其股东之间无关联关系。

三、拟发行价格区间

本次定向发行的每股价格区间为人民币 4.00 ~ 5.00 元。

四、预计募集资金金额

本次定向发行的预计募集资金金额为不超过人民币 12,500,000.00 元。

第六章 有关声明

一、公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

陆健 陆健

张文荣 张文荣

罗鹏 罗鹏

于涛 于涛

胡璨 胡璨

全体监事签字：

孙建刚 孙建刚

李秀峰 李秀峰

梁会锋 梁会锋

全体高级管理人员签字：

陆健 陆健

张文荣 张文荣

梁东 梁东

胡璨 胡璨

上海晟矽微电子股份有限公司

2013年6月25日



二、主办券商声明

本公司已对上海晟矽微电子股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：孙树明



项目负责人：张柯



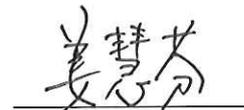
项目小组成员：王晶



杨亮亮

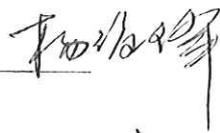


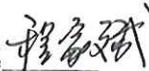
姜慧芬



三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读上海晟矽微电子股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：杨海峰 

程家斌 

律师事务所负责人：吴明德 

上海市锦天城律师事务所

2013年6月25日



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读上海晟矽微电子股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

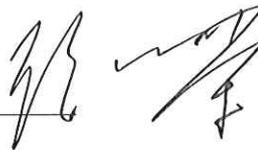
签字注册会计师：徐超玉



汪明卉



会计师事务所负责人：顾仁荣



中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)



2013年6月25日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读上海晟矽微电子股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：_____


汪和平


徐培明

资产评估机构负责人：_____


汪和平

北京金正元资产评估有限责任公司



2013年6月25日

第七章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2011 年度、2012 年度审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件